

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年7月21日(21.07.2016)



(10) 国際公開番号
WO 2016/113858 A1

- (51) 国際特許分類:
H02K 11/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/050779
- (22) 国際出願日: 2015年1月14日(14.01.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (71) 出願人: 株式会社安川電機(KABUSHIKI KAISHA YASKAWA DENKI) [JP/JP]; 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 Fukuoka (JP).
- (72) 発明者: 香月 陽介(KATSUKI Yosuke); 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP). 片山 寛(KATAYAMA Hiroshi); 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP). 小熊 清典(KOGUMA Kiyonori); 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP). 中道 徳馬(NAKAMICHI Tokuma); 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP). 貫 剛司(NUKI Koji); 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP). 樋口 雅人(HIGUCHI Masato); 〒8060004 福岡県北九州

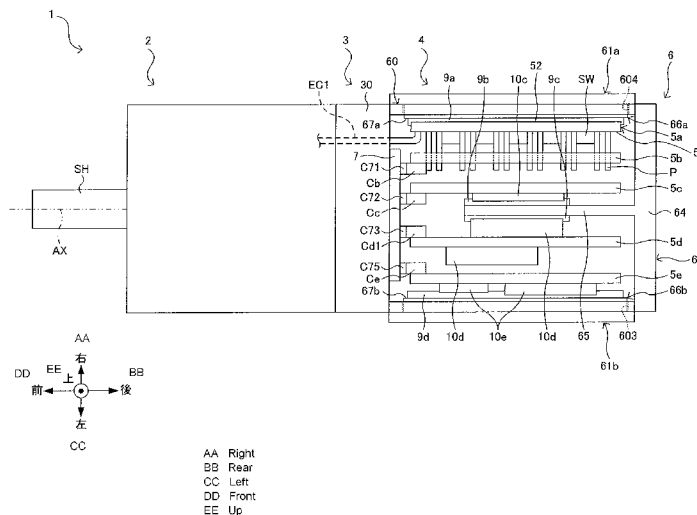
市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP). 氏田 祐(UJITA Yu); 〒8060004 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 株式会社安川電機内 Fukuoka (JP).

- (74) 代理人: 益田 博文, 外(MASUDA Hirofumi et al.); 〒1100015 東京都台東区東上野1-7-1 3 東上野上村ビル2階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

[続葉有]

(54) Title: MOTOR, AND MOTOR PRODUCTION METHOD

(54) 発明の名称: モータ及びモータの製造方法



(57) Abstract: [Problem] To improve heat dissipation properties of an amplifier unit. [Solution] This motor (1) is provided with: a motor unit (2) provided with a stator and a rotor; and an amplifier unit (4) which is provided with substrates (5a-5e) respectively disposed such that the surface direction is along the direction of the axis (AX) of the motor unit (2), and which supplies power to the motor unit (2). Furthermore, the amplifier unit (4) is provided with a frame (6) for accommodating the substrates (5a-5e). The frame (6) is provided with: a heat-dissipation-plate part (61a) for dissipating the heat from the power substrate (5a) among the substrates (5a-5e) which is disposed at one end; and a heat-dissipation-plate part (61b) for dissipating the heat from the control substrate (5e) among the substrates (5a-5e) which is disposed at another end.

(57) 要約:

[続葉有]



WO 2016/113858 A1



OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

【課題】アンプ部の放熱性を高める。【解決手段】モータ 1 は、固定子及び回転子を備えたモータ部 2 と、面方向がモータ部 2 の軸心 AX 方向に沿うように配置された基板 5 a ~ 5 e を備えモータ部 2 に電力を供給するアンプ部 4 とを有する。また、アンプ部 4 は、基板 5 a ~ 5 e を收容するフレーム 6 を有し、フレーム 6 は、基板 5 a ~ 5 e の一端に配置されたパワー基板 5 a の熱を放熱する放熱板部 6 1 a、及び、基板 5 a ~ 5 e の他端に配置された制御基板 5 e の熱を放熱する放熱板部 6 1 b を有する。

明 細 書

発明の名称： モータ及びモータの製造方法

技術分野

[0001] 開示の実施形態は、モータ及びモータの製造方法に関する。

背景技術

[0002] 特許文献1には、モータ駆動基板とセンサ回路用基板とをセンサカバー内に並設した駆動回路内蔵型サーボモータが記載されている。

先行技術文献

特許文献

[0003] 特許文献1：特開2004-274834号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0004] 上記従来技術では、モータ駆動基板とセンサ回路用基板は、基板の面方向がモータの回転軸方向に垂直となるように並設されている。このため、内側に配置されたセンサ回路用基板の熱がセンサカバー内にこもりやすく、放熱性が低いという課題があった。

[0005] 本発明はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、アンプ部の放熱性を高めることが可能なモータ及びモータの製造方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0006] 上記課題を解決するため、本発明の一の観点によれば、固定子及び回転子を備えたモータ部と、面方向が前記モータ部の回転軸方向に沿うように配置された複数の基板を備え、前記モータ部に電力を供給するように構成されたアンプ部と、を有するモータが適用される。

[0007] また、本発明の別の観点によれば、固定子及び回転子を備えたモータ部と、前記モータ部に電力を供給するように構成されたアンプ部と、を有するモータの製造方法であって、前記アンプ部の複数の基板を前記アンプ部のフレ

ームに前記モータ部の回転軸方向に沿って挿入すること、を有するモータの製造方法が適用される。

[0008] また、本発明のさらに別の観点によれば、固定子及び回転子を備えたモータ部と、複数の基板を備え、前記モータ部に電力を供給するように構成されたアンプ部と、前記複数の基板を収容するフレームと、前記フレームの少なくとも対向する2面を用いて前記基板の熱を放熱する手段と、を有するモータが適用される。

発明の効果

[0009] 本発明のモータ等によれば、アンプ部の放熱性を高めることができる。

図面の簡単な説明

[0010] [図1]一実施形態のモータの概略構成及びアンプ部の構成の一例を表す、フレームの上面部を透視した模式的な上面図である。

[図2]アンプ部の構成の一例を表す模式的な分解斜視図である。

[図3]アンプ部の構成の一例を表す、放熱板部を透視した模式的な左面図である。

[図4]アンプ部の構成の一例を表す、フレーム壁部を透視した模式的な後面図である。

[図5]基板の具体例及び基板・バックボードの接続関係の一例を表す模式図である。

[図6]パワー基板の放熱性を高める構成の具体例を表す模式図である。

[図7]ユニット化されたバックボードの構成の一例を表す模式的な平面図である。

[図8A]動力系のバックボードの構成の一例を表す模式的な平面図である。

[図8B]制御系のバックボードの構成の一例を表す模式的な平面図である。

[図9]モータの製造方法の一例を表す工程図である。

[図10]比較例の構成を表す模式図である。

[図11]フレーム内面の凸部により伝熱する変形例における、パワー基板の放熱性を高める構成の具体例を表す模式図である。

[図12]ガイド部材の段差に基板を嵌合する変形例のガイド部材の構成の一例を表す、フレーム壁部を透視した模式的な後面図である。

[図13]コネクタにより基板同士を直接的に電氣的に接続する変形例における、基板・バックボードの接続関係の一例を表す模式図である。

発明を実施するための形態

[0011] 以下、一実施形態について図面を参照しつつ説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能を有する構成要素については、原則として同一の符号で表し、これらの構成要素についての重複説明は、適宜省略する。また、図面中に注記された「前」「後」「左」「右」「上」「下」の方向は、本明細書の説明において「前」「後」「左」「右」「上」「下」と記述される方向にそれぞれ対応する。但し、モータ等の各構成要素の位置関係は、「前」「後」「左」「右」「上」「下」の概念に限定されるものではない。

[0012] <1. モータの概略構成の例>

まず、図1を参照しつつ、本実施形態のモータの概略構成の一例について説明する。

[0013] 図1に示すように、モータ1は、モータ部2と、エンコーダ部3と、アンプ部4とを有する、アンプ一体型のエンコーダ付きモータである。

[0014] モータ部2は、固定子及び回転子（どちらも図示せず）を備え、回転子が固定子に対し回転する回転型（ロータリタイプ）のモータ部である。モータ部2は、シャフトSHを軸心AX（「回転軸」の一例に相当）周りに回転させることで、回転力を出力する。軸心AX方向は、この例では前後方向となっている。本明細書では、モータ部2の回転力出力側、つまりモータ部2に対しシャフトSHが突出する側（この例では前側）を「負荷側」、その反対側（この例では後側）を「反負荷側」という。

[0015] なお、モータ部2を、固定子及び可動子を備え、可動子が固定子に対し直線移動する直線型（リニアタイプ）のモータ部としてもよい。

[0016] エンコーダ部3は、モータ部2の反負荷側（後側）に連結されている。エ

ンコーダ部3は、モータ部2の位置（「回転位置」や「回転角度」等ともいう）を検出し、その位置を表す位置データを出力する。

[0017] なお、エンコーダ部3をモータ部2の反負荷側に例えば減速機やブレーキ、回転方向変換機等の他の構成要素を介して連結してもよい。また、エンコーダ部3をモータ部2の負荷側に連結してもよい。また、エンコーダ部3は、モータ部2の位置に加え又は代え、モータ部2の速度（「回転速度」や「角速度」等ともいう）及び加速度（「回転加速度」や「角加速度」等ともいう）の少なくとも一方を検出してもよい。

[0018] アンプ部4は、エンコーダ部3の反負荷側（後側）に連結されている。アンプ部4は、モータ部2に電力を供給する。この際、アンプ部4は、エンコーダ部3から位置データを取得し、その位置データに基づいてモータ部2に印加する電流又は電圧等を制御することで、モータ部2の動作を制御する。また、アンプ部4は、上位制御装置（図示せず）から上位制御信号を取得し、その上位制御信号に表された位置等を実現可能な回転力がシャフトSHから出力されるように、モータ部2の動作を制御することもできる。

[0019] なお、アンプ部4をエンコーダ部3の反負荷側に他の構成要素を介して連結してもよい。また、アンプ部4を、モータ部2の反負荷側で、且つエンコーダ部3の負荷側、つまりモータ部2とエンコーダ部3との間に配置してもよい。また、アンプ部4をモータ部2の負荷側に連結してもよい。また、アンプ部4は、モータ部2に電力を供給するように構成されていればよく、必ずしもモータ部2を位置等の目標値に追従するよう制御するように構成されていなくてもよい。

[0020] なお、上記で説明したモータ1の構成は、あくまで一例であり、モータ1の構成は、上記構成に限定されるものではない。例えば、エンコーダ部3をモータ1とは別の装置により実装してもよい。

[0021] <2. アンプ部の構成の例>

次に、図1～図8A、Bを参照しつつ、アンプ部4の構成の一例について説明する。また、必要に応じてモータ部2やエンコーダ部3の構成の一例に

についても適宜説明する。なお、各図中では、アンブ部4の構成要素の図示を適宜省略している。

[0022] 図2に示すように、アンブ部4は、エンコーダ部3が備えるエンコーダカバー30の反負荷側（後側）の外面に例えば4つのねじS1により固定されている。

[0023] エンコーダカバー30の後面部の例えば四隅には、上記ねじS1が締結されるねじ穴31が形成されている。また、エンコーダカバー30の後面部の例えば右下隅部近傍には、後述の電力ケーブルEC1（図1等参照）が挿通される挿通孔32が貫通形成されている。さらに、エンコーダカバー30の後面部の例えば右上隅部近傍には、後述のねじS2の頭部が挿入される凹部33が形成されている。またさらに、エンコーダカバー30の後面部の例えば中心部近傍には、後述のコネクタC76（後述の図7等参照）等の部品が挿入される挿入孔34が貫通形成されている。

[0024] 図1～図4に示すように、アンブ部4は、複数（この例では5つ）の基板5a, 5b, 5c, 5d, 5eと、バックボード7（「中継基板」の一例に相当）と、フレーム6と、2つのガイド部材8a, 8bとを有する。なお、図1及び図2中では、ガイド部材8a, 8bの図示を省略している。

[0025] （2-1. 基板及びバックボードの構成の例）

図1～図4に示すように、基板5a～5eは、フレーム6に収容されている。基板5a～5eは、各々の面方向が軸心AX方向に沿うように（例えば軸心AX方向と平行になるように）並設されている。

[0026] 基板5a（「第1基板」の一例に相当）は、基板5a～5eの一端、つまり右端部に配置されている。基板5e（「第2基板」の一例に相当）は、基板5a～5eの他端、つまり基板5aとは反対側に位置する左端部に配置されている。なお、基板5a, 5eは、「複数の基板の端部に配置された基板」の一例に相当する。基板5bは、基板5a～5eの中で基板5aの左側に隣接配置されている。基板5cは、基板5a～5eの中で基板5bの左側に隣接配置されている。基板5dは、基板5a～5eの中で基板5cの左側で

、且つ基板5 eの右側に隣接配置されている。なお、基板5 a～5 eの中で左右両端を除く中間位置に配置された基板5 b～5 dのうち基板5 c, 5 dは、「第3基板」の一例に相当する。

[0027] なお、基板5の個数は、5つに限定されるものではなく、他の個数であってもよい。

[0028] バックボード7は、面方向が軸心AX方向に垂直となるようにフレーム6のモータ部2側、つまり前側に配置されている。バックボード7は、上記基板5 b～5 eを電氣的に接続し、データバスを構成する。

[0029] (2-1-1. 基板の具体例及び基板・バックボードの接続関係の例)

以下、図5を参照しつつ、基板5 a～5 eの具体例及び基板5 a～5 e・バックボード7の接続関係の一例について説明する。

[0030] 図5に示すように、アンプ部4は、主電源（図示せず）から入力される直流電力を交流電力（この例では3相交流電力）に変換し、モータ部2に供給する。

[0031] 基板5 dは、DC入力回路5 0 dを構成する部品を備えたDC入力基板である。以下適宜、基板5 dを「DC入力基板5 d」という。DC入力基板5 dには、2つのコネクタC d 1, C d 2が設けられている（図1、図2、及び図4も参照）。DC入力回路5 0 dは、主電源から直流電力を入力する。

[0032] 基板5 aは、インバータ回路5 0 a（「電力変換回路」の一例に相当）を構成して通電時に発熱する複数のスイッチング素子SW（「通電時に発熱する電子部品」の一例に相当。図5中では1つのみ図示）を含む部品を備えたパワー基板である。以下適宜、基板5 aを「パワー基板5 a」という。パワー基板5 aには、複数のピン端子P（図1及び図4参照）が設けられている。また、パワー基板5 aは、電力ケーブルEC 2を介してDC入力基板5 dと接続されると共に、電力ケーブルEC 1を介してモータ部2と接続されている（図1及び図4も参照）。インバータ回路5 0 aは、電力ケーブルEC 2を介してDC入力回路5 0 dから入力される直流電力をスイッチング素子

SW等により3相交流電力に変換し、電力ケーブルEC1を介してモータ部2に供給する。

[0033] 基板5bは、ゲート回路50bを構成する部品を備えたゲート基板である。以下適宜、基板5bを「ゲート基板5b」という。ゲート基板5bには、コネクタCbが設けられている（図1及び図4も参照）。ゲート回路50bは、インバータ回路50aのスイッチング素子SWを制御する。

[0034] なお、パワー基板5a及びそのインバータ回路50aと、ゲート基板5b及びそのゲート回路50bと、DC入力基板5d及びそのDC入力回路50dとは、モータ部2に3相交流電力を供給する主回路部500を構成する。

[0035] 基板5eは、制御回路50eを構成する部品を備えた制御基板である。以下適宜、基板5eを「制御基板5e」という。制御基板5eには、コネクタCeが設けられている（図1～図4も参照）。制御回路50eは、主回路部500を制御する。また、制御回路50eは、エンコーダ部3から位置データを入力する。

[0036] 基板5cは、電源回路50cを構成する部品を備えた電源基板である。以下適宜、基板5cを「電源基板5c」という。電源基板5cには、コネクタCcが設けられている（図1及び図4も参照）。電源回路50cは、ゲート回路50b及び制御回路50e等に制御用の電力を供給する。

[0037] バックボード7には、コネクタC71, C72, C73, C74, C75を含む複数のコネクタが設けられている（図1～図3も参照）。

[0038] そして、パワー基板5aは、上記ピン端子Pがゲート基板5bに取り付けられている（図1及び図4参照）。これにより、パワー基板5a及びゲート基板5bが、ピン端子Pを介して機械的及び電氣的に接続されている。

[0039] また、ゲート基板5bは、上記コネクタCbがバックボード7のコネクタC71と接続されており、電源基板5cは、上記コネクタCcがバックボード7のコネクタC72と接続されており、DC入力基板5dは、上記コネクタCd1, Cd2がそれぞれバックボード7のコネクタC73, C74と接続されており、制御基板5eは、上記コネクタCeがバックボード7のコネ

クタC75と接続されている（図1～図4も参照）。これにより、ゲート基板5b及び電源基板5c、ゲート基板5b及び制御基板5e、電源基板5c及び制御基板5e、DC入力基板5d及び主電源、DC入力基板5d及び制御基板5eが、それぞれバックボード7を介して電氣的に接続されている。

[0040] なお、上記で説明した基板5a～5eの種類及び基板5a～5e・バックボード7の接続関係は、あくまで一例であり、基板5a～5eの種類及び基板5a～5e・バックボード7の接続関係は、上記以外の内容であってもよい。

[0041] (2-2. フレームの構成の例)

図1～図4に示すように、フレーム6は、例えば略直方体状のフレーム筐体部60と、例えば略長方形板状の2つの放熱性を有する放熱板部61a、61b（以下適宜「放熱板部61」と総称）と、上下方向から見て略T字型の放熱性を有するフレームカバー部63（「放熱部材」及び「基板固定部材」の一例に相当）とを有する。

[0042] フレーム筐体部60には、上記基板5a～5eが並列された状態で収容されている。フレーム筐体部60の前面部、後面部、左面部、及び右面部には、それぞれ開口部601、602、603、604が形成されている。また、フレーム筐体部60の例えば前後方向から見た四隅には、上記ねじS1が挿通される挿通孔605が貫通形成されている。さらに、フレーム筐体部60の例えば上面部の後端部近傍には、後述のコネクタC77が挿入される挿入孔606が貫通形成されている。

[0043] 放熱板部61a（「第1放熱板材」の一例に相当）は、フレーム筐体部60の右面部の外面に例えばねじ等により着脱可能に取り付けられ、フレーム6の右壁部を構成する。放熱板部61aの内面には、フレーム筐体部60の開口部604に嵌合される例えば凸状の嵌合部66aが形成されている。また、放熱板部61aの内面、具体的には嵌合部66aの先端面67aの近傍には、上記パワー基板5aが配置されており、放熱板部61aは、伝熱されるパワー基板5aの熱を放熱する（詳細は後述）。

- [0044] 放熱板部61b（「第2放熱板材」の一例に相当）は、フレーム筐体部60の左面部の外面に例えばねじ等により着脱可能に取り付けられ、フレーム6の左壁部を構成する。放熱板部61bの内面には、フレーム筐体部60の開口部603に嵌合される例えば凸状の嵌合部66bが形成されている。また、放熱板部61bの内面、具体的には嵌合部66bの先端面67bの近傍には、上記制御基板5eが配置されており、放熱板部61bは、伝熱される制御基板5eの熱を放熱する（詳細は後述）。
- [0045] フレームカバー部63は、フレーム筐体部60のモータ部2とは反対側に位置する後面部の外面に取り付けられている。フレームカバー部63は、例えば略長方形板状のフレーム壁部64と、延設部65とを有する。
- [0046] フレーム壁部64の例えば四隅には、上記ねじS1が挿通される挿通孔641が貫通形成されている。各ねじS1は、フレーム壁部64の外側からフレーム壁部64の挿通孔641及びフレーム筐体部60の挿通孔605に挿通され、上記エンコーダカバー30のねじ穴31に締結されている。これにより、フレーム筐体部60は、エンコーダカバー30の後面部の外面に固定されており、フレーム壁部64は、フレーム筐体部60の後面部の外面に固定され、フレーム6の後側の壁部を構成する。
- [0047] 延設部65は、フレーム筐体部60内においてフレーム壁部64の内面から軸心AX方向に沿って（例えば軸心AX方向と平行に）延設されている。延設部65には、上記基板5a～5eが並設された状態で固定されている。具体的には、パワー基板5aとゲート基板5bとの間、ゲート基板5bと電源基板5cとの間、電源基板5cとDC入力基板5dとの間、DC入力基板5dと制御基板5eとの間には、それぞれスペーサとなる例えば樹脂製のパレットPa1, Pa2, Pa3, Pa4が配置されている。なお、図1、図3、及び図4中では、パレットPa1～Pa4の図示を省略している。そして、延設部65には、基板5a～5eがパレットPa1～Pa4を介して積層された状態で固定されている。延設部65の近傍には、電源基板5c及びDC入力基板5dが配置されており、フレームカバー部63は、伝熱される

電源基板 5 c 及び DC 入力基板 5 d の熱を放熱する（詳細は後述）。

[0048] なお、放熱板部 6 1 a, 6 1 b 及びフレームカバー部 6 3 は、「フレームの少なくとも対向する 2 面を用いて基板の熱を放熱する手段」の一例に相当する。

[0049] なお、上記で説明したフレーム 6 の構成は、あくまで一例であり、フレーム 6 は、基板 5 a ~ 5 e を収容可能な構成であれば、上記以外の構成であってもよい。例えば、放熱板部 6 1 a, 6 1 b の一方又は両方をフレーム筐体部 6 0 に着脱不能（フレーム筐体部 6 0 と一体の場合も含む）としてもよい。また、フレーム 6 は、放熱板部 6 1 a, 6 1 b のうち一方のみ備えてもよい。あるいは、フレーム 6 は、放熱板部 6 1 a, 6 1 b の両方を備えなくてもよい。また、フレームカバー部 6 3 が放熱する基板 5 は、基板 5 c, 5 d の両方に限定されるものではなく、基板 5 c のみ又は基板 5 d のみであってもよい。また、フレームカバー部 6 3 は、基板 5 c, 5 d に加え又は代え、基板 5 b の熱を放熱してもよい。また、フレームカバー部 6 3 は、基板 5 が固定される延設部を複数備えてもよい。

[0050] (2-3. ガイド部材の構成の例)

図 3 及び図 4 に示すように、ガイド部材 8 a, 8 b は、上記フレーム筐体部 6 0 の内側に固定されている。具体的には、ガイド部材 8 a, 8 b は、それぞれフレーム筐体部 6 0 の上面部の内面及び下面部の内面の対応する位置に固定されている。ガイド部材 8 a, 8 b の対向面の対応する複数（この例では 4 つ）の位置には、溝 8 1, 8 2, 8 3, 8 4（「凹部」の一例に相当）が軸心 A X 方向に沿って（例えば軸心 A X 方向と平行に）形成されている。

[0051] 溝 8 1 は、ガイド部材 8 a, 8 b の対向面の右端部に形成されている。溝 8 2 は、ガイド部材 8 a, 8 b の対向面における溝 8 1 の左側に所定距離を空けて形成されている。溝 8 3 は、ガイド部材 8 a, 8 b の対向面における溝 8 2 の左側に所定距離を空けて形成されている。溝 8 4 は、ガイド部材 8 a, 8 b の対向面における溝 8 3 の左側に所定距離を空けて、つまりガイド

部材 8 a, 8 b の対向面の左端部に形成されている。ガイド部材 8 a, 8 b の溝 8 1, 8 1、溝 8 2, 8 2、溝 8 3, 8 3、溝 8 4, 8 4 には、それぞれ上記ゲート基板 5 b の上下両端部、電源基板 5 c の上下両端部、DC 入力基板 5 d の上下両端部、制御基板 5 e の上下両端部が嵌合されている。このようにゲート基板 5 b、電源基板 5 c、DC 入力基板 5 d、制御基板 5 e を固定することで、ねじを用いずに固定することができる。

[0052] なお、上記で説明したガイド部材 8 a, 8 b の構成は、あくまで一例であり、ガイド部材は、基板 5 が嵌合される凹部が軸心 A X 方向に沿って形成された構成であれば、上記以外の構成であってもよい。例えば、ガイド部材に形成される、基板 5 が嵌合される凹部は、溝（スリット）に限定されるものではなく、他の形状の凹部（例えば段差等）であってもよい。また、ガイド部材の個数・形状は、上記個数・形状に限定されるものではなく、他の個数・形状であってもよい。また、ガイド部材を用いずに複数の基板 5 をフレーム 6 内に固定してもよく、この際、フレーム 6 の内面に軸心 A X 方向に沿って複数の凹部（例えば溝や段差等）を形成し、当該複数の凹部に複数の基板 5 を嵌合してもよい。

[0053] (2-4. 基板の放熱性を高める構成の例)

図 1 及び図 4 に示すように、パワー基板 5 a は、上記ピン端子 P がゲート基板 5 b に取り付けられ、上記放熱板部 6 1 a の先端面 6 7 a の近傍に配置されている。パワー基板 5 a の上記先端面 6 7 a とは反対側に位置する左表面 5 1（「第 1 表面」の一例に相当）には、比較的発熱量の大きな電子部品である上記複数のスイッチング素子 SW が配置されている。放熱板部 6 1 a の先端面 6 7 a とパワー基板 5 a の当該先端面 6 7 a 側に位置する右表面 5 2（「第 2 表面」の一例に相当）との間には、熱伝導性を有する熱伝導性シート 9 a（「熱伝導部材」の一例に相当）が配置されている。なお、図 2 及び図 3 中では、熱伝導性シート 9 a の図示を省略している。パワー基板 5 a は、熱伝導性シート 9 a を介して放熱板部 6 1 a の先端面 6 7 a に接触しており、放熱板部 6 1 a は、熱伝導性シート 9 a を介して伝熱されるパワー基

板 5 a の熱を放熱する。

[0054] (2-4-1. パワー基板の放熱性を高める構成の具体例)

以下、図 6 を参照しつつ、パワー基板 5 a の放熱性を高める構成の具体例について説明する。

[0055] 図 6 に示すように、パワー基板 5 a は、両面基板であり、左表面 5 1 及び右表面 5 2 には、それぞれ部品が配置されている。

[0056] パワー基板 5 a の左表面 5 1 には、上記スイッチング素子 SW が搭載されたスイッチ基板 5 3 や、当該パワー基板 5 a の厚み方向の寸法が比較的大きい部品 1 0 a 2 (以下適宜「高背部品 1 0 a 2」という) が配置されている。すなわち、パワー基板 5 a と上記放熱板部 6 1 a とは、スイッチング素子 SW に対し同一方向側 (右側) に配置されている。

[0057] スwitching素子 SW は、IC チップがパッケージに封入されずそのままパワー基板 5 a に実装されている。すなわち、スイッチング素子 SW は、パワー基板 5 a にベアチップ実装されている。スイッチ基板 5 3 は、例えばセラミック等の熱伝導性の高い材質で構成されている。スイッチ基板 5 3 には、スイッチング素子 SW への電力供給のためのボンディングワイヤ W が設けられている。

[0058] パワー基板 5 a の左表面 5 1 側に配置されたスイッチ基板 5 3、スイッチング素子 SW、ボンディングワイヤ W、高背部品 1 0 a 2 等は、樹脂 5 9 により封止されている。

[0059] パワー基板 5 a の右表面 5 2 には、当該パワー基板 5 a の厚み方向の寸法が比較的小さい、具体的には上記熱伝導性シート 9 a よりも小さい部品 1 0 a 1 (以下適宜「低背部品 1 0 a 1」という) が配置されている。低背部品 1 0 a 1 は、パワー基板 5 a の右表面 5 2 のスイッチ基板 5 3 に対応する領域以外の領域に配置され、熱伝導性シート 9 a により被覆されている。

[0060] パワー基板 5 a のスイッチ基板 5 3 に対応する領域には、複数のサーマルビア 5 4 が形成されている。サーマルビア 5 4 は、パワー基板 5 a に形成された貫通孔 5 5 に、例えば銅等の熱伝導性を有する熱伝導性材料 5 6 が充填

されることで構成されている（図6中の部分拡大図参照）。パワー基板5aのサーマルビア54形成部分は、当該パワー基板5aの厚み方向の熱抵抗が他の部分よりも小さくなっている。

[0061] 上記熱伝導性シート9aは、放熱板部61aの先端面67aとパワー基板5aの右表面52との間に、当該右表面52の少なくともスイッチ基板53に対応する領域（この例では右表面52の略全域）に接触するように配置されている。したがって、スイッチング素子SWの熱は、スイッチ基板53、パワー基板5a、及び熱伝導性シート9aを介して放熱板部61aに伝熱され、放熱板部61aにより放熱される。具体的には、熱伝導性シート9aは、熱伝導率に異方性を持たせた樹脂シートである。この例では、熱伝導性シート9aは、添加するフィラーの配向が調整されることで、面方向の熱伝導率が厚み方向よりも高い異方性を有する。このような熱伝導性シート9aを用いることで、スイッチング素子SWの熱をスイッチ基板53の対応する領域から面方向に拡散させ（図6中の部分拡大図に示す太線矢印を参照）、効率良く放熱板部61aに伝熱させることができる。また、例えば放熱板部61aによる放熱性を高める場合等には、放熱板部61aの外面にフィン等を設けてもよい。

[0062] なお、サーマルビア54及び熱伝導性シート9aは、「電子部品の熱を第1基板を介してフレームに伝熱する手段」の一例に相当する。

[0063] なお、上記で説明したパワー基板5aの放熱性を高める構成は、あくまで一例であり、パワー基板5aは、上記以外の構成により放熱性が確保されてもよい。例えば、パワー基板5aにサーマルビア54を形成するのに加え又は代え、パワー基板5aを例えばセラミック等の熱伝導性の高い材料で構成したり、パワー基板5aの内部に金属板を作り込む（メタルコア）又は貼り合わせる（メタルベース）等してもよい。また、熱伝導性シート9aとして、熱伝導率に異方性を有していない樹脂製又は非樹脂製のシートを用いてもよい。

[0064] また、上記ではスイッチング素子SWのICチップをベアチップ実装した

が、スイッチング素子SWのICチップを例えばQFN品等のような表面実装パッケージ品としてもよい。また、スイッチング素子SWを構成するICチップのパッケージを放熱面と端子面とが同一方向となるように構成してもよく、この場合、パッケージのサイズを小型化できる。

[0065] 図1、図3、及び図4に示すように、制御基板5eは、上下両端部が上記ガイド部材8a、8bの溝84、84に嵌合され、上記放熱板部61bの先端面67bの近傍に配置されている。制御基板5eの上記先端面67b側に位置する左表面には、例えば発熱量が上記スイッチング素子SWよりも小さい複数の電子部品10eが配置されている。放熱板部61bの先端面67bと制御基板5eの左表面との間には、熱伝導性を有する熱伝導性シート9d（「熱伝導部材」の一例に相当）が配置されている。なお、図2及び図3中では、熱伝導性シート9dの図示を省略している。熱伝導性シート9dは、上記熱伝導性シート9aと同様、熱伝導率に異方性を持たせた樹脂シートである。制御基板5eの電子部品10eは、熱伝導性シート9dを介して放熱板部61bの先端面67bに接触しており、放熱板部61bは、熱伝導性シート9dを介して伝熱される電子部品10eの熱を放熱する。

[0066] ゲート基板5bは、上記ピン端子Pを介してパワー基板5aと固定されると共に、上下両端部が上記ガイド部材8a、8bの溝81、81に嵌合され、パワー基板5aの近傍に配置されている。ゲート基板5bのパワー基板5aと反対側に位置する左表面には、例えば発熱量が小さい電子部品10bが配置されている。ゲート基板5bの電子部品10b等は、樹脂（図示せず）により封止されている。

[0067] 電源基板5cは、上下両端部が上記ガイド部材8a、8bの溝82、82に嵌合され、上記フレームカバー部63の延設部65の右表面の近傍に配置されている。電源基板5cの上記延設部65の右表面側に位置する左表面には、例えば発熱量が上記スイッチング素子SWよりも小さい電子部品10cが配置されている。延設部65の右表面と電源基板5cの左表面との間には、熱伝導性を有する熱伝導性シート9b（「熱伝導部材」の一例に相当）が

配置されている。なお、図2中では、熱伝導性シート9bの図示を省略している。熱伝導性シート9bは、上記熱伝導性シート9aと同様、熱伝導率に異方性を持たせた樹脂シートである。電源基板5cの電子部品10cは、熱伝導性シート9bを介して延設部65の右表面に接触している。

[0068] DC入力基板5dは、上下両端部が上記ガイド部材8a, 8bの溝83, 83に嵌合され、上記フレームカバー部63の延設部65の左表面の近傍に配置されている。DC入力基板5dの上記延設部65の左表面側に位置する右表面やその反対側である左表面には、例えば発熱量が上記スイッチング素子SWよりも小さい電子部品10dが配置されている。延設部65の左表面とDC入力基板5dの右表面との間には、熱伝導性を有する熱伝導性シート9c（「熱伝導部材」の一例に相当）が配置されている。なお、図2中では、熱伝導性シート9cの図示を省略している。熱伝導性シート9cは、上記熱伝導性シート9aと同様、熱伝導率に異方性を持たせた樹脂シートである。DC入力基板5dの右表面側の電子部品10dは、熱伝導性シート9cを介して延設部65の左表面に接触している。

[0069] したがって、延設部65には、熱伝導性シート9b, 9cを介して電源基板5cやDC入力基板5dの電子部品10c, 10dの熱が伝熱される。フレームカバー部63（フレーム壁部64）は、熱伝導性シート9b, 9cを介して伝熱される電子部品10c, 10dの熱を放熱する。

[0070] なお、上記で説明した基板5a~5eの放熱性を高める構成は、あくまで一例であり、基板5a~5eは、上記以外の構成により放熱性が確保されてもよい。例えば、熱伝導性シート9a~9dの一部又は全部に代え、他の熱伝導性部材を用いてもよい。また、アンプ部4は、熱伝導性シート9a~9dの一部又は全部を備えていなくてもよい。

[0071] （2-5. バックボードの構成の例）

図2、図7、及び図8A, Bに示すように、バックボード7は、複数（この例では2つ）のバックボード7a, 7b（「中継基板」の一例に相当）が樹脂321により一体的に封止されることでユニット化され、基板ユニット

70として構成されている。なお、図1及び図3～図5中では、基板ユニット70としてではなく、1つの基板状のバックボード7として模式的に図示している。

[0072] 基板ユニット70は、上記フレーム筐体部60の開口部601に取り付けられ、フレーム筐体部60の前面部に例えば1つのねじS2により固定されている。基板ユニット70の中では、バックボード7a、7bは、バックボード7aが後側、バックボード7bが前側となるように、軸心AX方向に並設されている。

[0073] バックボード7aの後表面には、上記コネクタC73が設けられている。また、バックボード7aの例えば前表面には、上記主電源と接続されるコネクタC77が設けられている。すなわち、バックボード7aには、高い電圧システムの動力線が配置されており、バックボード7aは、動力系のバックボードを構成する。

[0074] バックボード7bの後表面には、上記コネクタC71、C72、C74、C75が設けられている。また、バックボード7bの前表面には、エンコーダ部3と接続されるコネクタC76が設けられている。すなわち、バックボード7bには、低い電圧システムの信号線が配置されており、バックボード7bは、制御系のバックボードを構成する。

[0075] また、バックボード7aには、上記ねじS2が挿通される挿通孔73が形成された固定片部72が設けられている。ねじS2は、基板ユニット70の前側からバックボード7aの挿通孔73に挿通され、フレーム筐体部60の前面部に締結されている。これにより、基板ユニット70は、上記フレーム筐体部60の開口部601に取り付けられ、フレーム筐体部60の前面部に固定されている。この際、上記コネクタC77は、上記フレーム筐体部60の挿入孔606に挿入される。また、アンプ部4が上記エンコーダカバー30の後面部の外面上に取り付けられる際、上記コネクタC76等の部品及び上記ねじS2の頭部は、それぞれ上記エンコーダカバー30の挿入孔34及び凹部33に挿入される。

[0076] なお、上記で説明したバックボード7の構成は、あくまで一例であり、バックボード7は、基板5 a～5 eの少なくとも1枚を電氣的に接続可能な構成であれば、上記以外の構成であってもよい。例えば、バックボード7は、複数のバックボードにより構成されるが、複数のバックボードが樹脂7 1により一体的に封止された構成でなくてもよい。また、バックボード7を1枚のバックボードで構成してもよい。また、基板5 a～5 eをバックボード7を用いずに（例えばケーブルやコネクタ等により）電氣的に接続してもよい。

[0077] <3. モータの製造方法の例>

次に、図9を参照しつつ、モータ1の製造方法の一例について説明する。

[0078] 図9に示すように、モータ1の製造方法によるモータ1の製造工程（組立工程）では、主工程が実行される前に（又は主工程と並行して）、パワー基板5 aとゲート基板5 bとの接続工程、及び、基板ユニット7 0の製造工程が実行される。

[0079] パワー基板5 aとゲート基板5 bとの接続工程では、パワー基板5 aのスイッチ基板5 3、スイッチング素子SW、ボンディングワイヤW、高背部品1 0 a 2等が、樹脂5 9により封止される。また、ゲート基板5 bの電子部品1 0 b等が、樹脂により封止される。そして、樹脂封止されたパワー基板5 aと樹脂封止されたゲート基板5 bとの間にパレットP a 1が介在された状態で、パワー基板5 aのピン端子Pがゲート基板5 bに取り付けられ、例えば半田等により接続（接合）される。これにより、パワー基板5 aとゲート基板5 bとの結合体が完成する。

[0080] また、基板ユニット7 0の製造工程では、バックボード7 a, 7 bが、例えば半田等により接続（接合）された後、樹脂7 1により一体的に封止される。これにより、基板ユニット7 0が完成する。

[0081] また、主工程では、フレームカバー部6 3の延設部6 5に、熱伝導性シート9 bを介して電源基板5 cが組み付けられる。また、フレームカバー部6 3の延設部6 5に、熱伝導性シート9 c及びパレットP a 3を介してDC入

力基板 5 d が組み付けられる。その後、電源基板 5 c 及び DC 入力基板 5 d が固定されたフレームカバー部 6 3 の延設部 6 5 における DC 入力基板 5 d 側に、パレット P a 4 を介して制御基板 5 e が組み付けられる。そして、電源基板 5 c、DC 入力基板 5 d、及び制御基板 5 e が固定されたフレームカバー部 6 3 の延設部 6 5 における電源基板 5 c 側に、パレット P a 2 を介して上記パワー基板 5 a とゲート基板 5 b との結合体におけるゲート基板 5 b 側が組み付けられる。以上により、フレームカバー部 6 3 の延設部 6 5 に、基板 5 a ~ 5 e が並設された状態で固定される。

[0082] その後、フレームカバー部 6 3 の延設部 6 5、及び、延設部 6 5 に固定された基板 5 a ~ 5 e が、開口部 6 0 2 から軸心 A X 方向に沿ってフレーム筐体部 6 0 に挿入される。この際、延設部 6 5 及び各基板 5 a ~ 5 e は、ゲート基板 5 b、電源基板 5 c、DC 入力基板 5 d、制御基板 5 e の各々の上下両端部がフレーム筐体部 6 0 内のガイド部材 8 a、8 b の溝 8 1 ~ 8 4 にそれぞれ嵌合されるように挿入される。

[0083] そして、基板ユニット 7 0 が、バックボード 7 a、7 b の各コネクタがフレーム筐体部 6 0 内のゲート基板 5 b、電源基板 5 c、DC 入力基板 5 d、及び制御基板 5 e の対応する各コネクタと接続されるように、フレーム筐体部 6 0 の開口部 6 0 1 に組み付けられる。

[0084] その後、放熱板部 6 1 a が、嵌合部 6 6 a の先端面 6 7 a が熱伝導性シート 9 a を介してフレーム筐体部 6 0 内のパワー基板 5 a に接触されるように、フレーム筐体部 6 0 の右面部の外面（開口部 6 0 4）に組み付けられる。また、放熱板部 6 1 b が、嵌合部 6 6 b の先端面 6 7 b が熱伝導性シート 9 d を介してフレーム筐体部 6 0 内の制御基板 5 e の電子部品 1 0 e に接触されるように、フレーム筐体部 6 0 の左面部の外面（開口部 6 0 3）に組み付けられる。これにより、アンプ部 4 が完成する。

[0085] そして、アンプ部 4 がエンコーダ部 3 のエンコーダカバー 3 0 の反負荷側の外面に組み付けられる。これにより、モータ部 2、エンコーダ部 3、及びアンプ部 4 を有するモータ 1 が完成する。

[0086] 上記で説明したモータ1の製造方法による各工程は、1つ以上の製造装置により自動的に実行される。但し、当該各工程の一部は、人手により実行されてもよい。

[0087] また、上記で説明したモータ1の製造方法によるモータ1の製造工程は、あくまで一例であり、モータ1の製造工程は、上記で説明した順序に沿って時系列的に行われる工程はもちろん、必ずしも時系列的に実行されなくても、並列的に又は個別的に実行される工程をも含む。また、時系列的に実行される工程でも、場合によっては適宜順序を変更することが可能である。また、上記では、パワー基板5aを、フレームカバー部63の延設部65に固定した状態でフレーム筐体部60に挿入したが、放熱板部61aに熱伝導性シート9aを介して組み付けた状態でフレーム筐体部60に挿入してもよい。

[0088] <4. 本実施形態による効果の例>

以上説明したように、本実施形態のモータ1は、モータ部2とアンプ部4とを備えたアンプ一体型のモータである。

[0089] このようなモータ1において、仮に、アンプ部4の基板5a~5eをそれらの面方向が軸心AX方向に垂直となるように配置した場合、モータ部2とは反対側の端部に配置された基板5については放熱性が良いが、内側に配置されたその他の基板5については放熱性が低くなり、熱がアンプ部4内にこもりやすい。また、モータ1を径方向に小型化する場合の放熱面積への影響が大きいので、放熱性の面で小型化が制約される可能性がある。

[0090] 本実施形態では、アンプ部4の基板5a~5eは、それらの面方向が軸心AX方向に沿うように配置される。すなわち、モータ1の組立時に、アンプ部4の基板5a~5eをフレーム筐体部60に軸心AX方向に沿って挿入することで、組み立てられたモータ1のアンプ部4では、基板5a~5eはそれらの面方向が軸心AX方向に沿うように並設されることとなる。これにより、少なくとも両端に配置された基板5a, 5eについて放熱性を良くすることができるので、アンプ部4の放熱性を高めることができる。また、モータ1を径方向に小型化する場合の放熱面積への影響を少なくできるので、さ

らなる小型化が可能となる。

[0091] また、本実施形態では特に、フレーム6が、パワー基板5aの熱を放熱する放熱板部61aと、制御基板5eの熱を放熱する放熱板部61bとを有する。これにより、基板5a、5eの熱をフレーム6（の放熱板部61a、61b）に伝熱させて効率的に放熱できるので、アンプ部4の放熱性を高めることができる。

[0092] また、本実施形態では特に、次のような効果を得ることができる。すなわち、基板5a、5eの部品面には、複数の電子部品が実装されている。このとき、各電子部品の高さの相違によって、基板5a、5eの部品面には、凹凸が生じる。そこで、パワー基板5aと放熱板部61aとの間、制御基板5eと放熱板部61bとの間に熱伝導性シート9a、9dを設けることにより、上記電子部品による凹凸を吸収し、基板5a、5eの電子部品と放熱板部61a、61bとの熱的な接触面積を増大することができる。したがって、基板5a、5eの放熱性を高めることができる。また、本実施形態のように、熱伝導部材として、熱伝導に異方性を持たせた熱伝導性シート9a、9dを用いることで、基板5a、5eから放熱板部61a、61bへの熱伝導率を高め、放熱性をさらに高めることが可能となる。

[0093] また、本実施形態では特に、次のような効果を得ることができる。すなわち、仮に、放熱板部61a、61bとフレーム筐体部60とを一体構造とした場合、基板5a、5eをフレーム6に対し軸心AX方向に挿抜する構造上、パワー基板5aと放熱板部61aとの間及び制御基板5eと放熱板部61bとの間に隙間を設ける等が必要となり、基板5a、5eと放熱板部61a、61bとの熱的な接触面積の減少を招く可能性がある。本実施形態では、放熱板部61a、61bをフレーム筐体部60に対し着脱可能な構成とするので、基板5a、5eをフレーム筐体部60に收容した後で放熱板部61a、61bをフレーム筐体部60に取り付けることができる。これにより、基板5a、5eと放熱板部61a、61bとの熱的な接触面積を確保することが可能となり、放熱性を高めることができる。

- [0094] また、本実施形態では特に、フレームカバー部63が、基板5c, 5dの熱を放熱する。基板5が3枚以上の場合、両端を除く中間位置に配置された基板5c, 5dの熱は放熱しにくく、アンプ部4内にこもりやすい。本実施形態では、基板5c, 5dの熱をフレームカバー部63を介してモータ部2とは反対側に放熱することができるので、アンプ部4の放熱性をさらに高めることができる。
- [0095] また、本実施形態では特に、フレームカバー部63に、基板5a~5eが並設された状態で固定される。これにより、基板5a~5eの固定構造を堅固にできる。また、モータ1の組立作業時に、フレームカバー部63をモータ部2とは反対側からアンプ部4に装着することで、基板5a~5eを一度に取り付けることができるので、モータ1の組立作業を容易化できる。また、基板5a~5eをフレームカバー部63に固定する際に、樹脂製のパレットPa1~Pa4等を介して基板5a~5eを積層させることで、必要な基板間距離（絶縁距離）を確保することが可能となる。また、基板5a~5eをフレームカバー部63に固定する際に、必要な基板間のコネクタ接続等を予め行っておくことで、その後の組立作業を容易化することが可能である。
- [0096] また、本実施形態では特に、フレームカバー部63が、フレーム6のモータ部2とは反対側の壁部を構成するフレーム壁部64と、フレーム筐体部60内においてフレーム壁部64から軸心AX方向に沿って延設され、基板5a~5eが固定される延設部65とを有する。これにより、フレーム6の一部であるフレーム壁部64を、基板5c, 5dの放熱部材及び固定部材として活用することができる。したがって、アンプ部4の放熱性を高めることができると共に、部品の削減やモータ1の小型化が可能となる。
- [0097] また、本実施形態では特に、バックボード7を用いて基板5b~5e間の接続を行う。これにより、アンプ部4内の省配線化が可能となる。
- [0098] また、本実施形態では特に、バックボード7が、軸心AX方向に並設されたバックボード7a, 7bが樹脂71により一体的に封止された構成である。これにより、バックボード7を、動力系のバックボードと制御系のバック

ボードとに分離した構成とすることが可能となる。その結果、高い電圧システムの動力線と低い電圧システムの信号線とが1つのバックボード上に混在するのを回避でき、絶縁またはノイズ等に対する信頼性を向上できる。また、バックボード7 a, 7 bを一体的に樹脂封止することでユニット化でき、組立作業性を向上できる。

[0099] また、本実施形態では特に、アンプ部4が、フレーム筐体部60の内側に配置され、基板5 b~5 eが嵌合される溝8 1~8 4が軸心A X方向に沿って形成されたガイド部材8 a, 8 bを有する。ガイド部材8 a, 8 bの溝8 1~8 4により、基板5 a~5 eをフレーム筐体部60に挿抜する際に基板5 b~5 eが軸心A X方向に案内されるので、基板5 a~5 eの挿抜作業が容易となる。また、ガイド部材8 a, 8 bの溝8 1~8 4により基板5 b~5 eの間隔を固定（位置決め）できるので、必要な基板間距離（絶縁距離）を確保することができる。

[0100] また、本実施形態では特に、基板5 a~5 eは、当該基板5 a~5 eの端部に配置され、インバータ回路50 aを構成するスイッチング素子SWを備えたパワー基板5 aを含む。これにより、比較的発熱量の大きいパワー基板5 aの放熱性を確保できる。

[0101] また、本実施形態では特に、基板5 a~5 eは、当該基板5 a~5 eのパワー基板5 aとは反対側の端部に配置され、制御回路50 eを備えた制御基板5 eを含む。これにより、制御基板5 eをパワー基板5 aから離間させてノイズの影響を低減することができる。また、制御基板5 e（のCPUやASIC等による熱）の放熱性を確保できる。

[0102] また、本実施形態では特に、次のような効果を得ることができる。

[0103] 以下、図10に、比較例の構成を示す。図10に示す比較例では、スイッチング素子SWが搭載されたスイッチ基板53は、熱伝導性を有するベースBを介してヒートシンク100（「本実施形態の放熱板部61 a」に相当）に取り付けられている。スイッチング素子SWのICチップは、パッケージ57に封入されている。また、スイッチ基板53は、ヒートシンク100と

は反対側に位置するパワー基板5 aにピン端子5 8により接続されている。

[0104] 本実施形態では、スイッチング素子SWに対してパワー基板5 aと放熱板部6 1 aとが同一方向側に配置される。これにより、本実施形態のようにスイッチング素子SWのICチップをパッケージに封入せずにそのままパワー基板5 aに実装するベアチップ実装が可能となる。したがって、スイッチング素子SWを小型化できる。さらに、上記比較例の構成の場合、ヒートシンク1 0 0とパワー基板5 aとの間にスイッチング素子SWの高さ分の無駄な空間が必要となる。本実施形態では、放熱板部6 1 aとパワー基板5 aとの間に熱伝導性シート9 aが配置され、スイッチング素子SWは配置されないため、上記無駄な空間を少なくできる。以上により、アンプ部4の小型化を実現できる。

[0105] また、本実施形態では、パワー基板5 aと放熱板部6 1 aの先端面6 7 aとの間に、パワー基板5 aの右表面5 2の少なくともスイッチング素子SWに対応する領域に接触する熱伝導性シート9 aが配置されるので、スイッチング素子SWの熱をパワー基板5 aから放熱板部6 1 aに効率良く伝熱できる。したがって、アンプ部4の放熱性を確保できる。

[0106] また、本実施形態では特に、パワー基板5 aのスイッチング素子SWに対応する領域には、貫通孔5 5内に熱伝導性材料5 6が充填されたサーマルビア5 4が形成される。これにより、サーマルビア5 4形成部分ではパワー基板5 aの厚み方向の熱抵抗を小さくできるので、スイッチング素子SWの熱を熱伝導性シート9 aに効率的に伝熱できる。したがって、アンプ部4の放熱性を高めることができる。

[0107] また、本実施形態では特に、熱伝導性シート9 aとして、熱伝導率に異方性を有する樹脂シートを用いる。この際、本実施形態のように面方向の熱伝導率が厚み方向よりも高い異方性を有する樹脂シートである熱伝導性シート9 aを用いることで、スイッチング素子SWの熱をパワー基板5 aのスイッチング素子SWに対応する領域から面方向に拡散させて、さらに効率良く放熱板部6 1 aに伝熱させることが可能となる。したがって、アンプ部4の放

熱性をさらに高めることができる。また、樹脂製の熱伝導性シート 9 a を用いることでパワー基板 5 a と放熱板部 6 1 a との絶縁を確保できると共に、金属同士の接合を少なくできるので半田の使用量を低減できる。

[0108] また、本実施形態では特に、パワー基板 5 a の右表面 5 2 には、パワー基板 5 a の厚み方向の寸法が熱伝導性シート 9 a よりも小さい低背部品 1 0 a 1 が配置される。これにより、右表面 5 2 に配置された低背部品 1 0 a 1 が熱伝導性シート 9 a により被覆される構造となるので、熱伝導性シート 9 a と放熱板部 6 1 a の先端面 6 7 a との熱的な接触面積を増大でき、アンプ部 4 の放熱性をさらに高めることができる。また、パワー基板 5 a の右表面 5 2 にパワー基板 5 a の厚み方向の寸法が比較的小さい低背部品 1 0 a 1 を配置し、左表面 5 1 に上記寸法が比較的大きい高背部品 1 0 a 2 をスイッチング素子 SW と共に配置することで、パワー基板 5 a を放熱板部 6 1 a の先端面 6 7 a に近接配置することができる。したがって、さらなる小型化を実現できる。

[0109] また、本実施形態では特に、スイッチング素子 SW が搭載されたスイッチ基板 5 3 がパワー基板 5 a の左表面 5 1 に配置される。そして、熱伝導性シート 9 a がパワー基板 5 a の右表面 5 2 の少なくともスイッチ基板 5 3 に対応する領域に接触するように配置される。これにより、スイッチング素子 SW の熱をスイッチ基板 5 3 からパワー基板 5 a を介して放熱板部 6 1 a に効率良く伝熱できる。また、スイッチ基板 5 3 を、本実施形態のようにセラミック等の熱伝導性の高い材質で構成することで、放熱性をさらに高めることが可能である。

[0110] なお、上記で説明した本実施形態による効果及び当該効果を得ることができる構成は、あくまで一例であり、本実施形態による効果及び当該効果を得ることができる構成は、上記内容に限定されるものではない。

[0111] <4. 変形例等>

なお、実施形態は、上記内容に限られるものではなく、その趣旨及び技術的思想を逸脱しない範囲内で種々の変形が可能である。以下、そのような変

形例を説明する。

[0112] (4-1. フレーム内面の凸部により伝熱する場合)

以下、図11を参照しつつ、本変形例のパワー基板5aの放熱性を高める構成の一例について説明する。

[0113] 図11に示すように、本変形例の放熱板部61a' (「第1放熱板部」の一例に相当)は、嵌合部66a'の先端面67a'からパワー基板5aに向けて突出した凸部610 (「熱伝導部材」の一例に相当)を備える。凸部610は、前述の熱伝導性シート9aに代わり、放熱板部61a'の先端面67a'とパワー基板5aの右表面52との間に、当該右表面52の前述のスイッチ基板53に対応する領域に接触するように配置されている。したがって、スイッチング素子SWの熱は、スイッチ基板53、パワー基板5a、及び凸部610を介して放熱板部61a'に伝熱され、放熱板部61a'により放熱される。

[0114] なお、本変形例では、放熱板部61a'、前述の放熱板部61b、及び前述のフレームカバー部63が、「フレームの少なくとも対向する2面を用いて基板の熱を放熱する手段」の一例に相当する。また、前述のサーマルビア54及び凸部610が、「電子部品の熱を第1基板を介してフレームに伝熱する手段」の一例に相当する。

[0115] 本変形例においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本変形例では、放熱板部61a'の先端面67a'からパワー基板5aに向けて突出した凸部610により、スイッチング素子SWの熱をパワー基板5aから放熱板部61a'に効率良く伝熱できる。また、熱伝導部材を別途容易する必要がないので、部品を削減でき、構成を簡素化できる。

[0116] (4-2. ガイド部材の段差に基板を嵌合する場合)

以下、図12を参照しつつ、本変形例のガイド部材の構成の一例について説明する。

[0117] 図12に示すように、本変形例では、フレーム筐体部60の内側に、ガイド部材8c、8dが固定されている。ガイド部材8c、8dは、それぞれフ

レーム筐体部60の右寄りの内面及び左寄りの内面の対応する位置に固定されている。

- [0118] ガイド部材8cの右表面における上下方向中央部近傍には、軸心AX方向に沿った溝801が形成されている。溝801には、ゲート基板5bの左表面に配置された電子部品10bやコネクタCb、ゲート基板5bの左側に突出したピン端子Pの先端部等が配置されている。また、ガイド部材8cの右表面における溝801の上下両縁部には、段差85, 85（「凹部」の一例に相当）が軸心AX方向に沿って（例えば軸心AX方向と平行に）形成されている。段差85, 85には、ゲート基板5bが嵌合されている。
- [0119] ガイド部材8cの左表面における上下方向中央部近傍には、軸心AX方向に沿った溝802が形成されている。また、ガイド部材8cの左表面における溝801の上下両縁部には、段差86, 86（「凹部」の一例に相当）が軸心AX方向に沿って（例えば軸心AX方向と平行に）形成されている。段差86, 86には、電源基板5cが嵌合されている。
- [0120] ガイド部材8dの右表面における上下方向中央部近傍には、軸心AX方向に沿った溝803が形成されている。溝803には、DC入力基板5dの左表面に配置された電子部品10d等が配置されている。また、ガイド部材8dの右表面における溝803の上下両縁部には、段差87, 87（「凹部」の一例に相当）が軸心AX方向に沿って（例えば軸心AX方向と平行に）形成されている。段差87, 87には、DC入力基板5dが嵌合されている。
- [0121] ガイド部材8dの左表面における上下方向中央部近傍には、軸心AX方向に沿った溝804が形成されている。溝804には、制御基板5eの右表面に配置されたコネクタCe等が配置されている。また、ガイド部材8dの左表面における溝804の上下両縁部には、段差88, 88（「凹部」の一例に相当）が軸心AX方向に沿って（例えば軸心AX方向と平行に）形成されている。段差88, 88には、制御基板5eが嵌合されている。
- [0122] 本変形例においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。すなわち、本変形例によれば、基板5a～5eをフレーム筐体部60に挿抜す

る際に、ガイド部材 8 c, 8 d の段差 8 5 ~ 8 8 により基板 5 b ~ 5 e が軸心 A X 方向に案内されるので、基板 5 a ~ 5 e の挿抜作業が容易となる。また、ガイド部材 8 c, 8 d の段差 8 5 ~ 8 8 により基板 5 b ~ 5 e の間隔を固定できるので、必要な基板間距離を確保することができる。

- [0123] (4-3. コネクタにより基板同士を直接的に電氣的に接続する場合)
以下、図 1 3 を参照しつつ、本変形例の基板 5 a ~ 5 e ・バックボードの接続関係の一例について説明する。
- [0124] 図 1 3 に示すように、本変形例では、DC 入力基板 5 d には、3 つのコネクタ C d 1, C d 2, C d 3 が設けられている。パワー基板 5 a は、上記実施形態と同様、電力ケーブル E C 2 を介して DC 入力基板 5 d と接続されると共に、電力ケーブル E C 1 を介して前述のモータ部 2 と接続されている。また、パワー基板 5 a には、コネクタ C a が設けられている。ゲート基板 5 b には、3 つのコネクタ C b, C c 2, C b 3 が設けられている。制御基板 5 e には、コネクタ C e が設けられている。電源基板 5 c には、3 つのコネクタ C c, C c 2, C c 3 が設けられている。
- [0125] また、本変形例のバックボード 7' には、コネクタ C 7 1, C 7 2, C 7 3, C 7 4, C 7 5 を含む複数のコネクタが設けられている。
- [0126] そして、パワー基板 5 a 及びゲート基板 5 b は、上記実施形態と同様、前述のピン端子 P を介して機械的及び電氣的に接続されている。
- [0127] また、ゲート基板 5 b は、上記コネクタ C b がバックボード 7' のコネクタ C 7 1 と接続されており、電源基板 5 c は、上記コネクタ C c がバックボード 7' のコネクタ C 7 2 と接続されており、DC 入力基板 5 d は、上記コネクタ C d 1, C d 2 がそれぞれバックボード 7' のコネクタ C 7 3, C 7 4 と接続されており、制御基板 5 e は、上記コネクタ C e がバックボード 7' のコネクタ C 7 5 と接続されている。また、前述のエンコーダ部 3 は、バックボード 7' と電氣的に接続されている。これにより、ゲート基板 5 b 及び制御基板 5 e、電源基板 5 c 及び制御基板 5 e、DC 入力基板 5 d 及び主電源、DC 入力基板 5 d 及び制御基板 5 e、エンコーダ部 3 及び制御基板 5

eが、それぞれバックボード7'を介して電氣的に接続されている。

[0128] さらに、パワー基板5 aは、上記コネクタC aがゲート基板5 bの上記コネクタC b 2と接続されており、ゲート基板5 bは、上記コネクタC b 3が電源基板5 cの上記コネクタC c 2と接続されており、電源基板5 cは、上記コネクタC c 3がDC入力基板5 dの上記コネクタC d 3と接続されている。これにより、パワー基板5 a及びゲート基板5 b、ゲート基板5 b及び電源基板5 c、電源基板5 c及びDC入力基板5 dが、それぞれコネクタC a, C b 2、コネクタC b 3, C c 2、コネクタC c 3, C d 3により直接的に電氣的に接続されている。

[0129] なお、コネクタC a, C b 2, C b 3, C c 2, C c 3, C d 3は、「複数の基板同士を電氣的に接続するコネクタ」の一例に相当する。

[0130] なお、上記で説明した基板5 a～5 e・バックボード7'の接続関係は、あくまで一例であり、基板5 a～5 e・バックボード7'の接続関係は、上記以外の内容であってもよい。例えば、上記では、ゲート基板5 b及び制御基板5 e、電源基板5 c及び制御基板5 e、DC入力基板5 d及び主電源、DC入力基板5 d及び制御基板5 e、エンコーダ部3及び制御基板5 eを、それぞれバックボード7'を介して電氣的に接続したが、これらの一部又は全部をコネクタにより直接的に電氣的に接続してもよい。また、上記では、パワー基板5 a及びゲート基板5 b、ゲート基板5 b及び電源基板5 c、電源基板5 c及びDC入力基板5 dを、それぞれコネクタC a, C b 2、コネクタC b 3, C c 2、コネクタC c 3, C d 3により直接的に電氣的に接続したが、これらの一部又は全部をバックボードを介して電氣的に接続してもよい。

[0131] 本変形例においても、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。また、本変形例では、コネクタC a, C b 2を用いて基板5 a, 5 b間の直接接続を行い、コネクタC b 3, C c 2を用いて基板5 b, 5 c間の直接接続を行い、コネクタC c 3, C d 3を用いて基板5 c, 5 d間の直接接続を行う。これにより、アンプ部4内のさらなる省配線化が可能となる。

[0132] (4-4. その他)

以上の説明において、「垂直」「平行」「平面」等の記載がある場合には、当該記載は厳密な意味ではない。すなわち、それら「垂直」「平行」「平面」等とは、設計上、製造上の公差、誤差が許容され、「実質的に垂直」「実質的に平行」「実質的に平面」等という意味である。

[0133] また、以上の説明において、外観上の寸法や大きさが「同一」「等しい」「異なる」等の記載がある場合は、当該記載は厳密な意味ではない。すなわち、それら「同一」「等しい」「異なる」等とは、設計上、製造上の公差、誤差が許容され、「実質的に同一」「実質的に等しい」「実質的に異なる」等という意味である。

[0134] また、以上既に述べた以外にも、上記実施形態や各変形例による手法を適宜組み合わせ利用してもよい。

[0135] その他、一々例示はしないが、上記実施形態や各変形例は、その趣旨を逸脱しない範囲内において、種々の変更が加えられて実施されるものである。

符号の説明

[0136]	1	モータ
	2	モータ部
	4	アンプ部
	5 a	パワー基板（第1基板、基板の一例）
	5 b	ゲート基板
	5 c	電源基板（第3基板、基板の一例）
	5 d	DC入力基板（第3基板、基板の一例）
	5 e	制御基板（第2基板、基板の一例）
	6	フレーム
	7	バックボード（中継基板の一例）
	7'	バックボード（中継基板の一例）
	7 a, b	バックボード（中継基板の一例）
	8 a, b	ガイド部材

8 c, d	ガイド部材
9 a ~ d	熱伝導性シート（熱伝導部材、樹脂シートの一例）
1 0 a 1	低背部品（部品の一例）
5 0 a	インバータ回路（電力変換回路の一例）
5 0 e	制御回路
5 1	左表面（第 1 表面の一例）
5 2	右表面（第 2 表面の一例）
5 3	スイッチ基板
5 4	サーマルビア
5 5	貫通孔
5 6	熱伝導性材料
6 3	フレームカバー部（放熱部材、基板固定部材の一例）
6 4	フレーム壁部
6 5	延設部
6 1 a	放熱板部（第 1 放熱板部の一例）
6 1 a'	放熱板部（第 1 放熱板部の一例）
6 1 b	放熱板部（第 2 放熱板部の一例）
7 1	樹脂
8 1 ~ 8 4	溝（凹部の一例）
8 5 ~ 8 8	段差（凹部の一例）
5 0 0	主回路部
6 0 3	開口部
6 0 4	開口部
6 1 0	凸部
A X	軸心（回転軸の一例）
C a	コネクタ
C b 2, C b 3	コネクタ
C c 2, C c 3	コネクタ

C d 3	コネクタ
SW	スイッチング素子（通電時に発熱する電子部品の一例）

請求の範囲

- [請求項1] 固定子及び回転子を備えたモータ部と、
面方向が前記モータ部の回転軸方向に沿うように配置された複数の基板を備え、前記モータ部に電力を供給するように構成されたアンプ部と、
を有することを特徴とするモータ。
- [請求項2] 前記アンプ部は、
前記複数の基板を収容するフレームを有し、
前記フレームは、
前記複数の基板の一端に配置された第1基板の熱を放熱するように構成された第1放熱板部、及び、前記複数の基板の他端に配置された第2基板の熱を放熱するように構成された第2放熱板部、の少なくとも一方を有する
ことを特徴とする請求項1に記載のモータ。
- [請求項3] 前記アンプ部は、
前記第1基板と前記第1放熱板部との間、及び、前記第2基板と前記第2放熱板部との間、の少なくとも一方に配置された熱伝導部材を有する
ことを特徴とする請求項2に記載のモータ。
- [請求項4] 前記第1放熱板部及び前記第2放熱板部の少なくとも一方は、
前記フレームに着脱可能である
ことを特徴とする請求項2又は3に記載のモータ。
- [請求項5] 前記アンプ部は、
前記モータ部とは反対側に配置され、前記複数の基板の中で両端を除く中間位置に配置された第3基板の熱を放熱するように構成された放熱部材を有する
ことを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のモータ。
- [請求項6] 前記アンプ部は、

前記モータ部とは反対側に配置され、前記複数の基板が並設された状態で固定された基板固定部材を有する

ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のモータ。

[請求項7]

前記アンプ部は、

前記複数の基板を収容するフレームを有し、

放熱部材又は基板固定部材は、

前記フレームの前記モータ部とは反対側の壁部を構成するフレーム壁部と、

前記フレーム内において前記フレーム壁部から前記回転軸方向に沿って延設され、前記基板が固定される延設部と、を有する

ことを特徴とする請求項 5 又は 6 に記載のモータ。

[請求項8]

前記アンプ部は、

面方向が前記回転軸方向に垂直となるように前記モータ部側に配置され、前記複数の基板の少なくとも 1 枚を電氣的に接続する中継基板を有する

ことを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載のモータ。

[請求項9]

前記中継基板は、

前記回転軸方向に並設された複数の中継基板が樹脂により一体的に封止された構成である

ことを特徴とする請求項 8 に記載のモータ。

[請求項10]

前記アンプ部は、

前記複数の基板同士を電氣的に接続する少なくとも 1 つのコネクタを有する

ことを特徴とする請求項 8 又は 9 に記載のモータ。

[請求項11]

前記アンプ部は、

前記複数の基板を収容するフレームと、

前記フレームの内側に配置され、前記基板が嵌合される凹部が前記回転軸方向に沿って形成されたガイド部材と、を有する

ことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 10 のいずれか 1 項に記載のモータ。

[請求項12] 前記複数の基板は、
当該複数の基板の端部に配置され、電力変換回路を構成するスイッチング素子を備えたパワー基板を含む
ことを特徴とする請求項 1 乃至 11 のいずれか 1 項に記載のモータ。

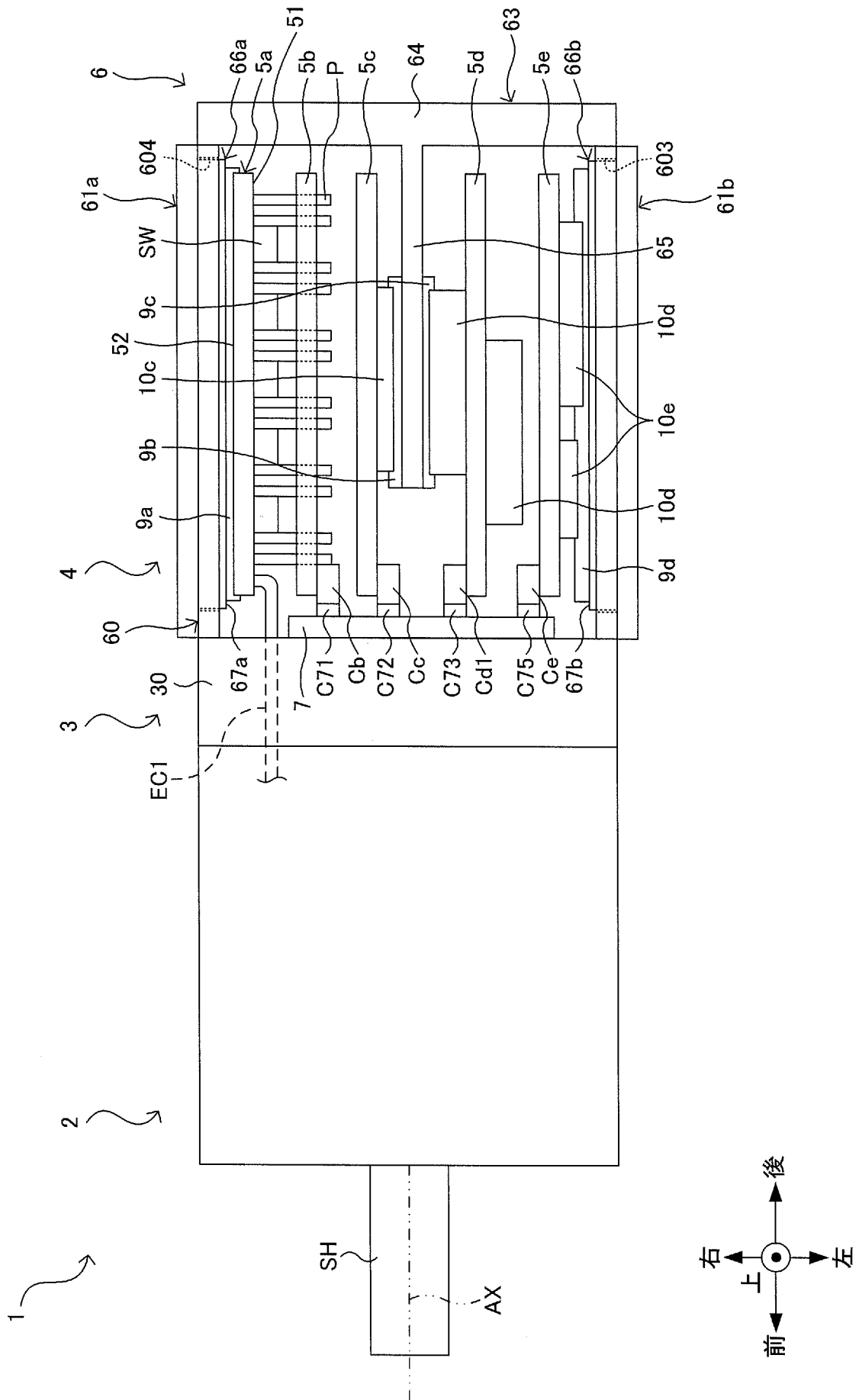
[請求項13] 前記複数の基板は、
当該複数の基板の前記パワー基板とは反対側の端部に配置され、制御回路を備えた制御基板を含む
ことを特徴とする請求項 12 に記載のモータ。

[請求項14] 固定子及び回転子を備えたモータ部と、前記モータ部に電力を供給するように構成されたアンプ部と、を有するモータの製造方法であって、
前記アンプ部の複数の基板を前記アンプ部のフレームに前記モータ部の回転軸方向に沿って挿入すること、を有する
ことを特徴とするモータの製造方法。

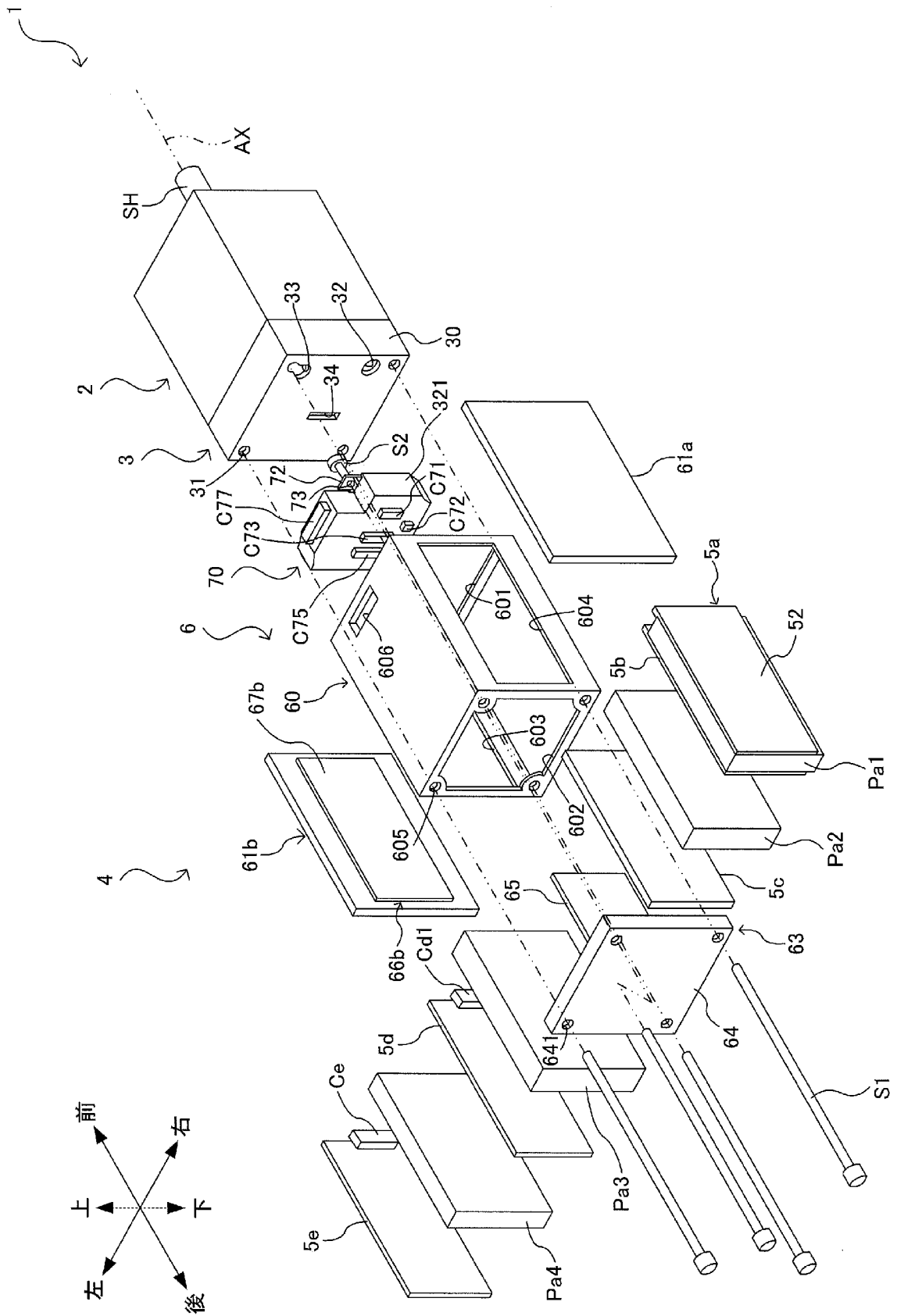
[請求項15] 前記複数の基板を前記フレームに挿入する前に、前記複数の基板を並設した状態で固定すること、をさらに有する
ことを特徴とする請求項 14 に記載のモータの製造方法。

[請求項16] 挿入された前記複数の基板の端部に配置された基板に対応して前記フレームに形成された開口部に、前記基板の熱を放熱するように構成された放熱板部を取り付けること、をさらに有する
ことを特徴とする請求項 14 又は 15 に記載のモータの製造方法。

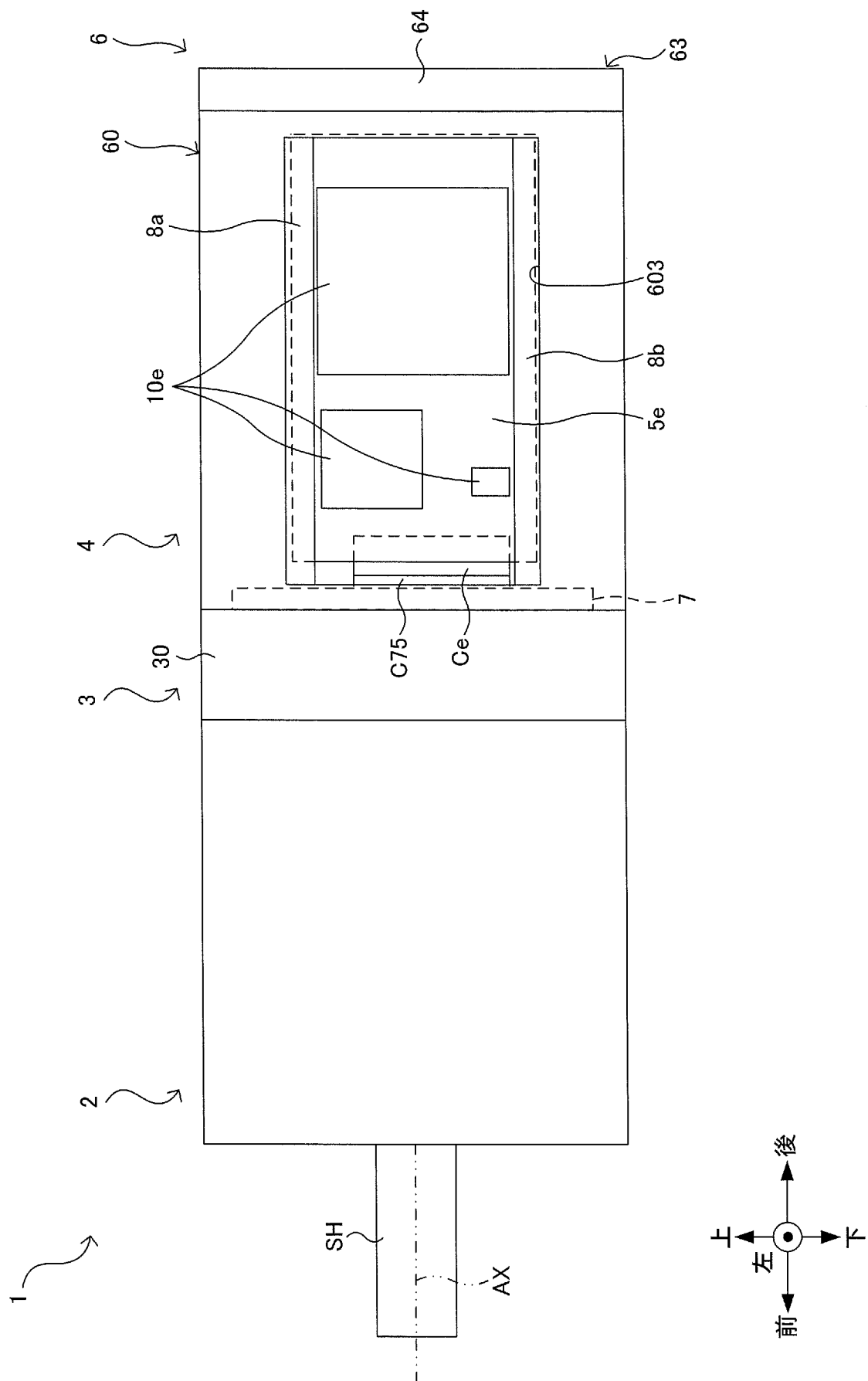
[図1]



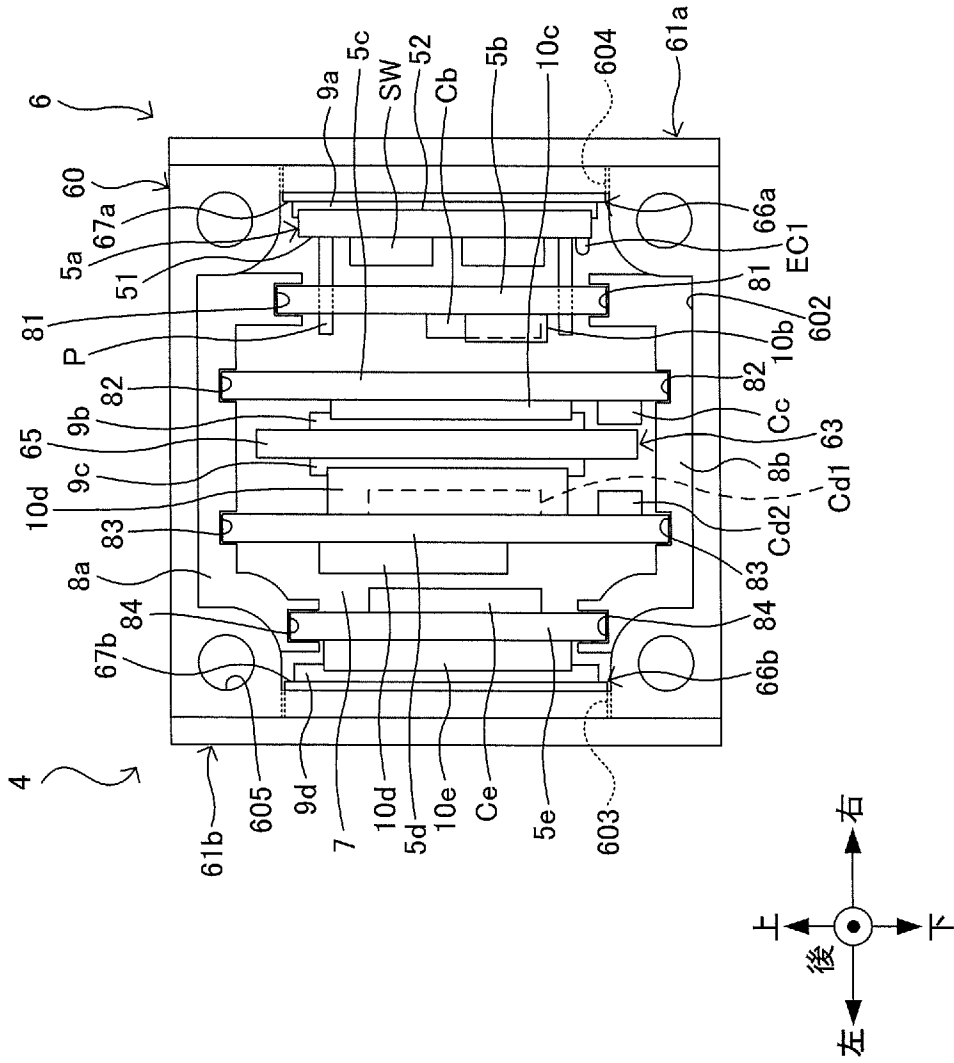
[図2]



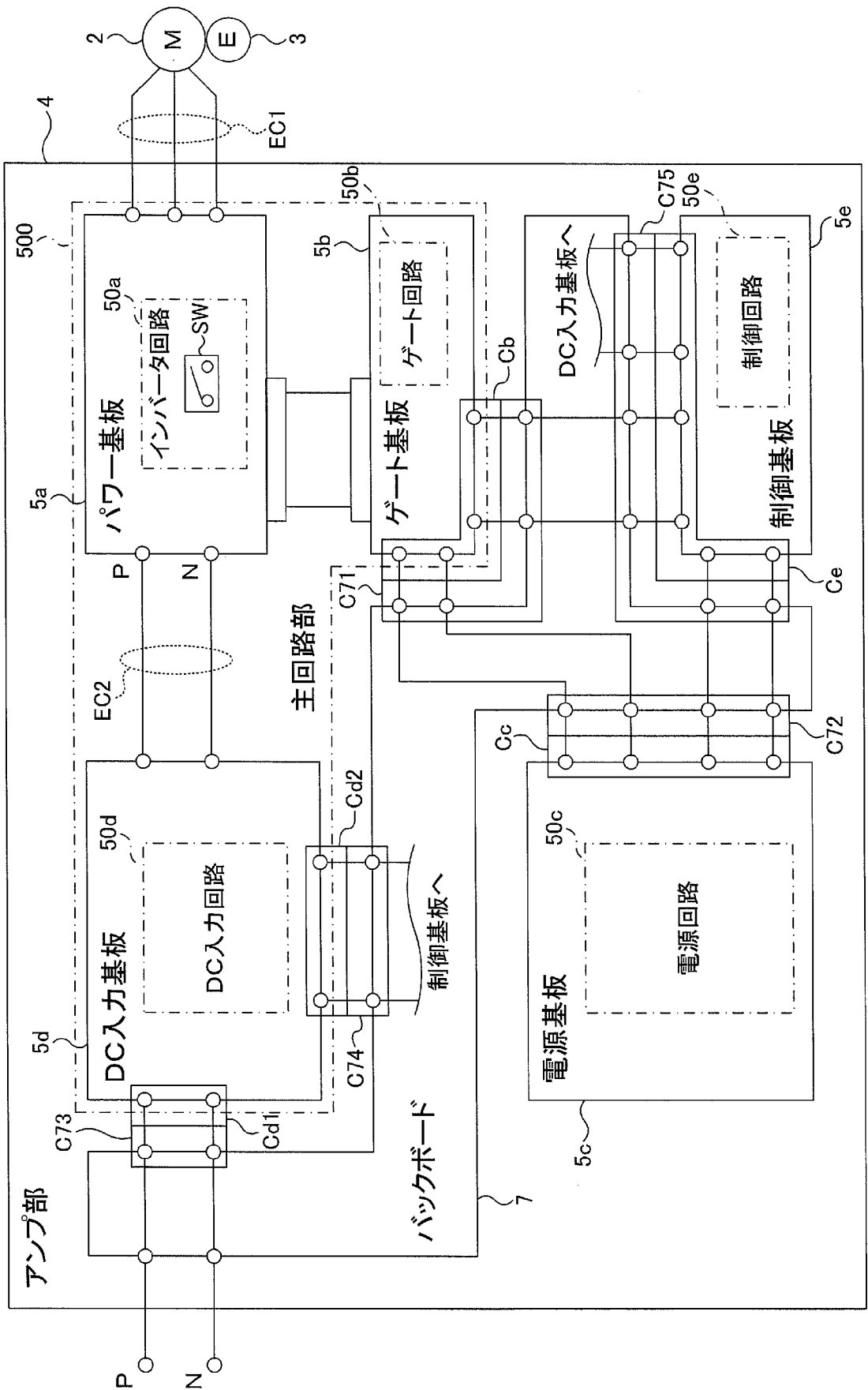
[図3]



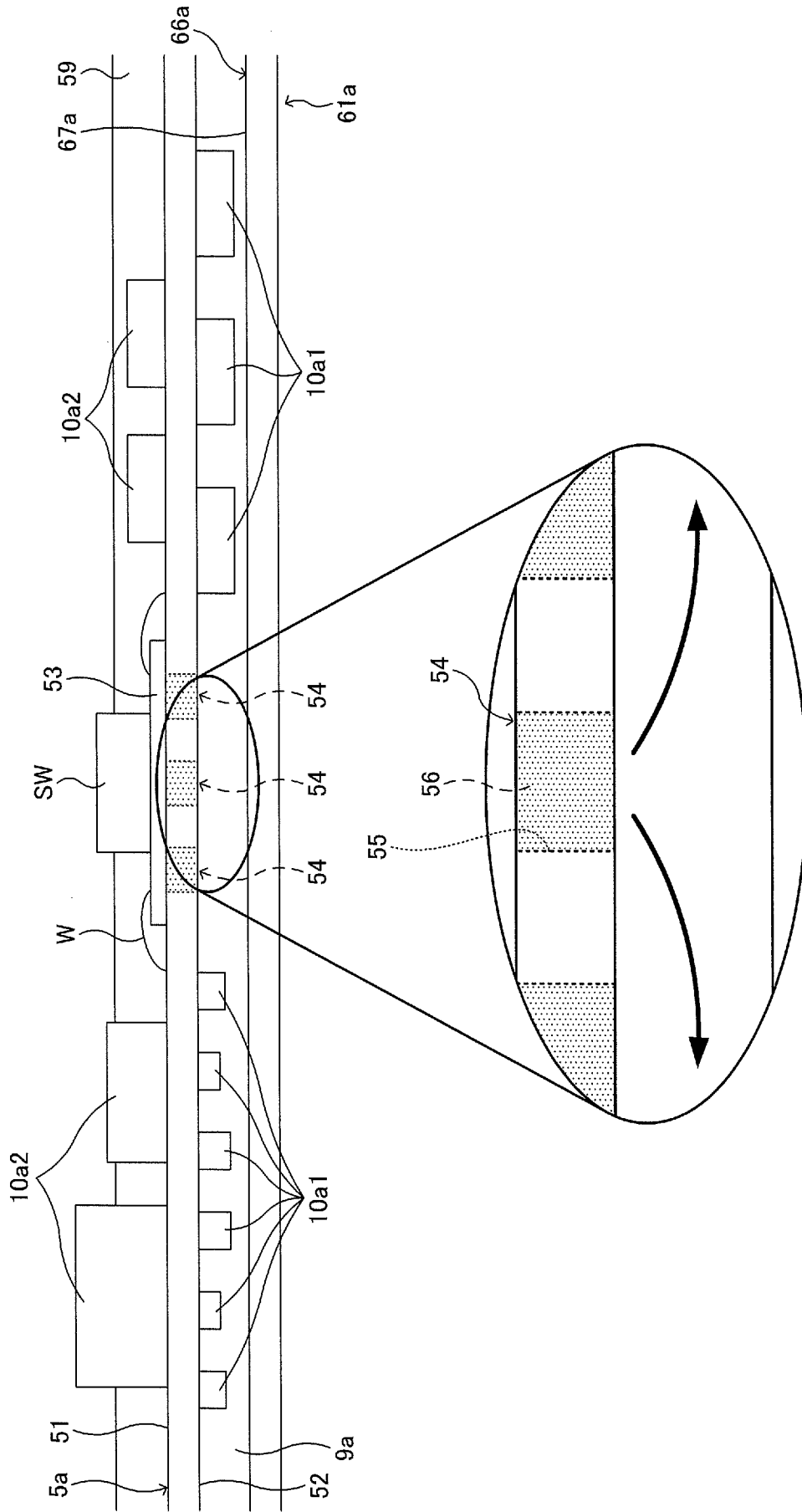
[図4]



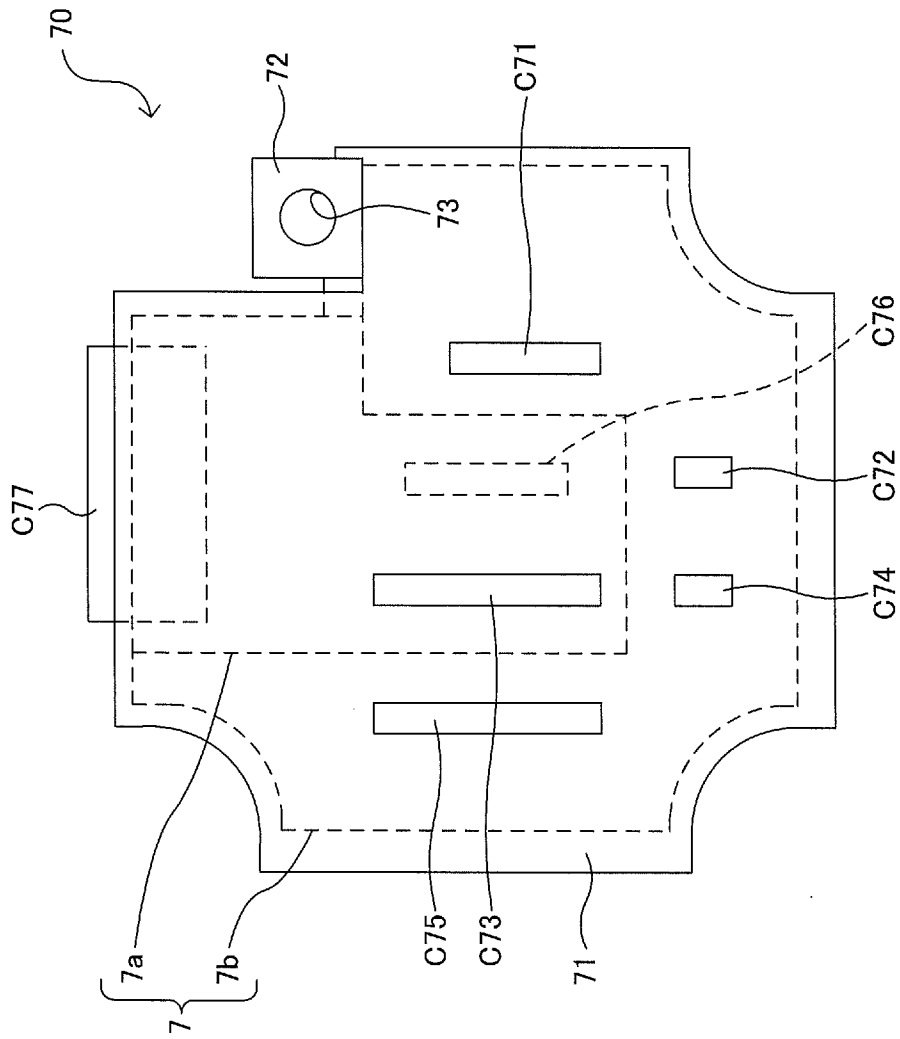
[図5]



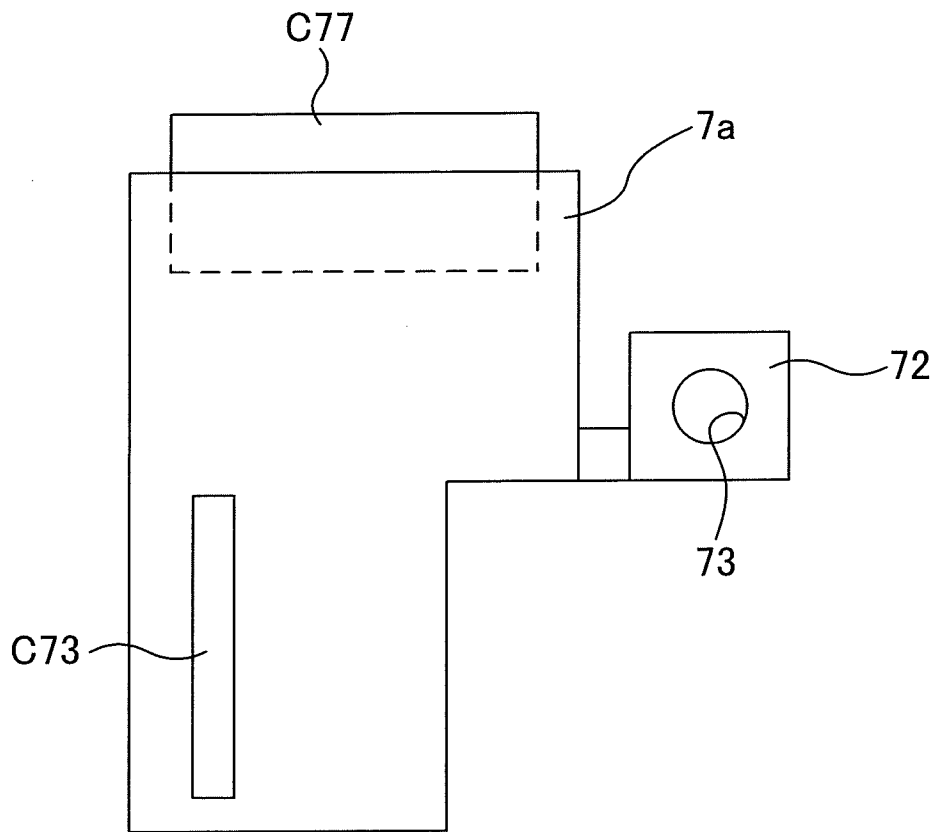
[図6]



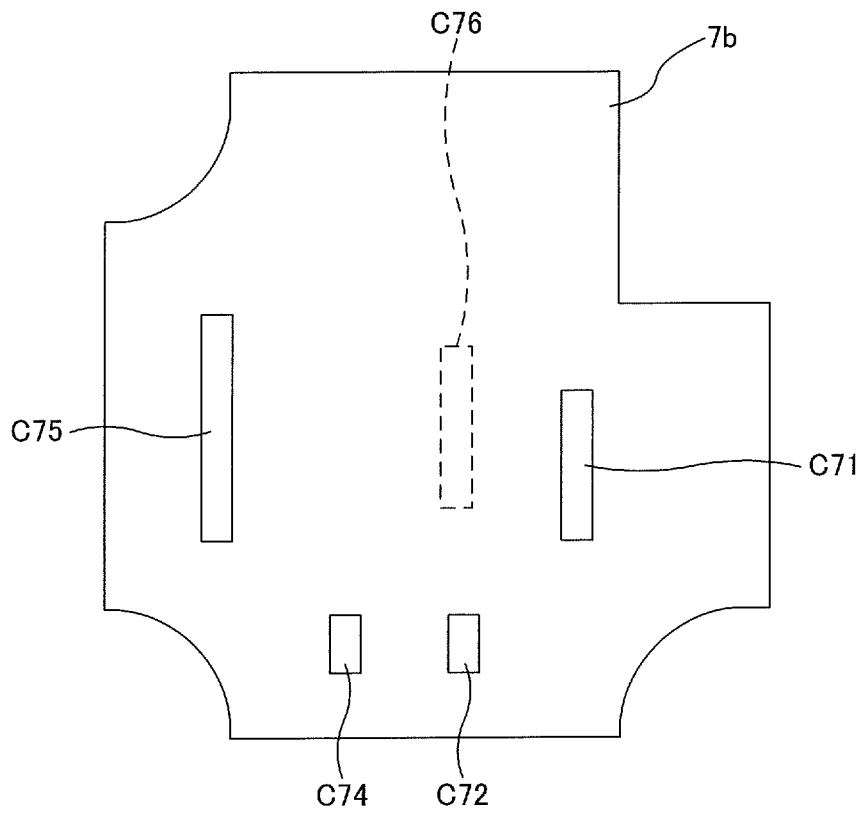
[図7]



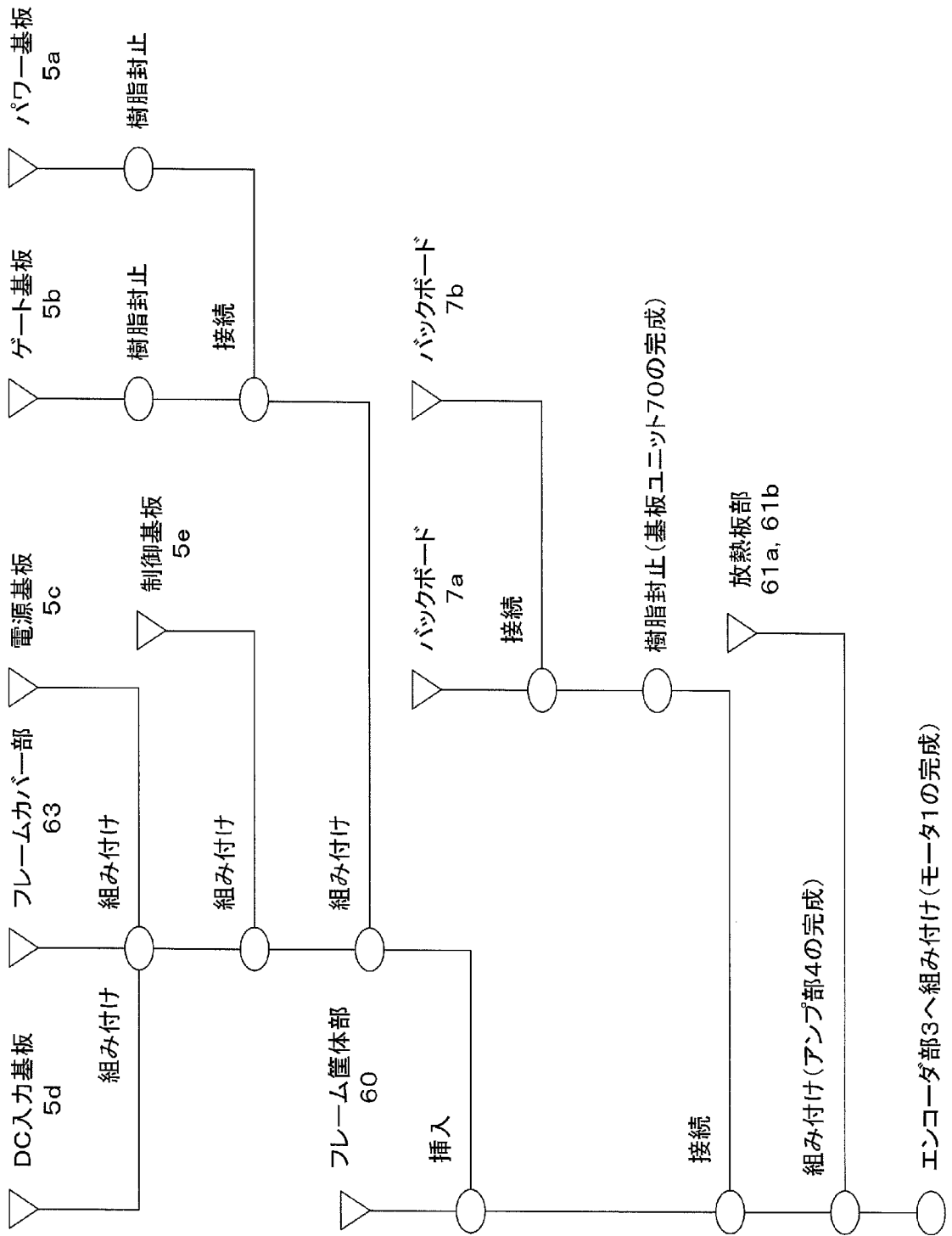
[図8A]



[図8B]

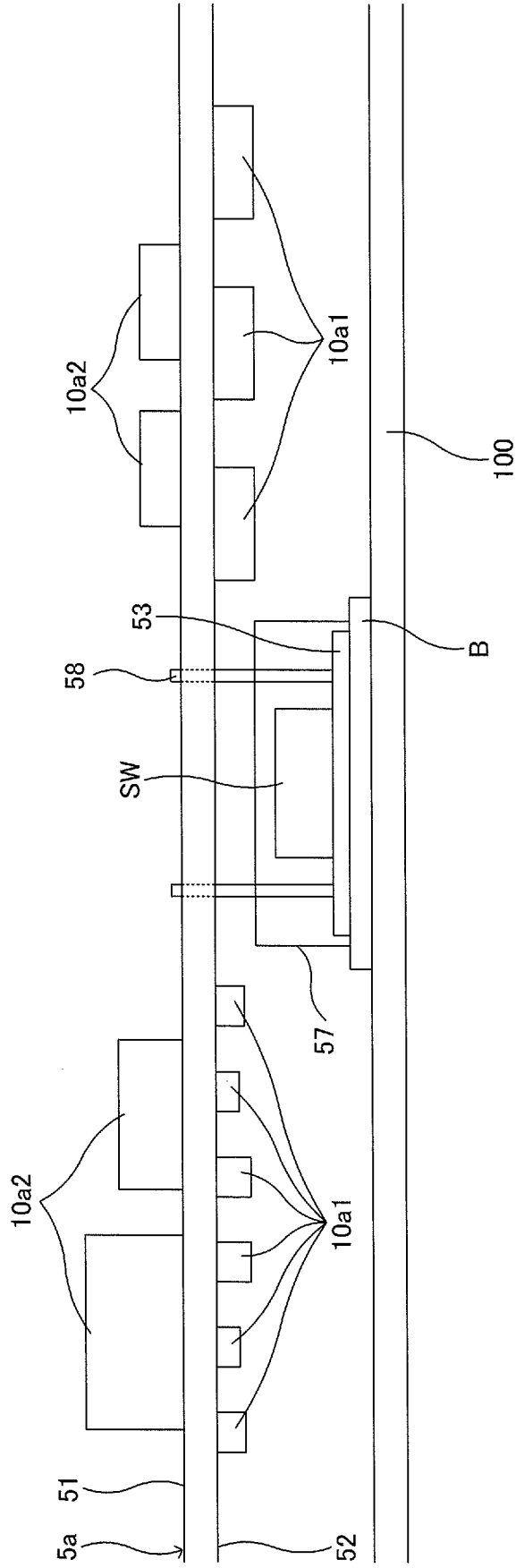


[図9]

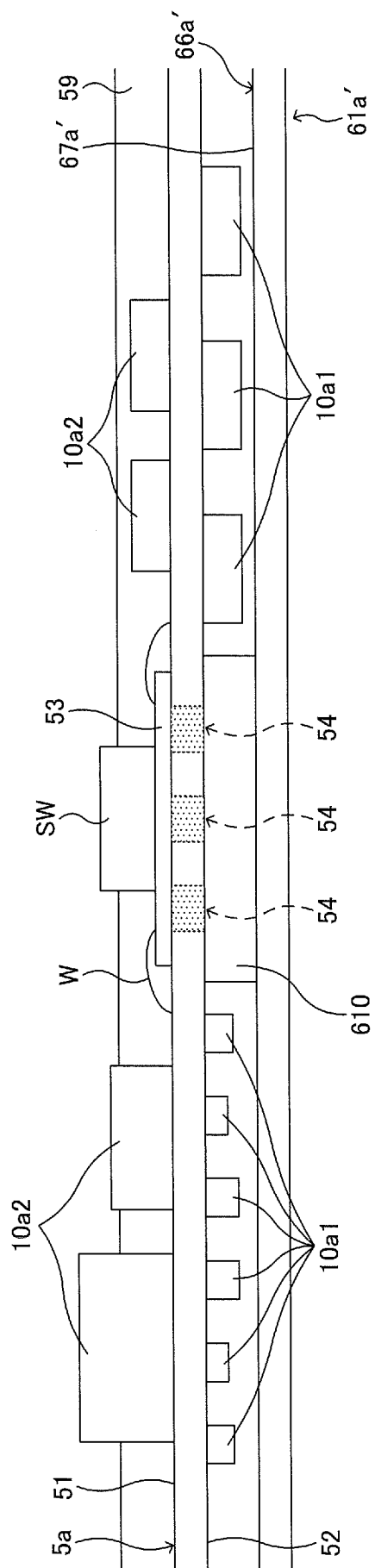


[図10]

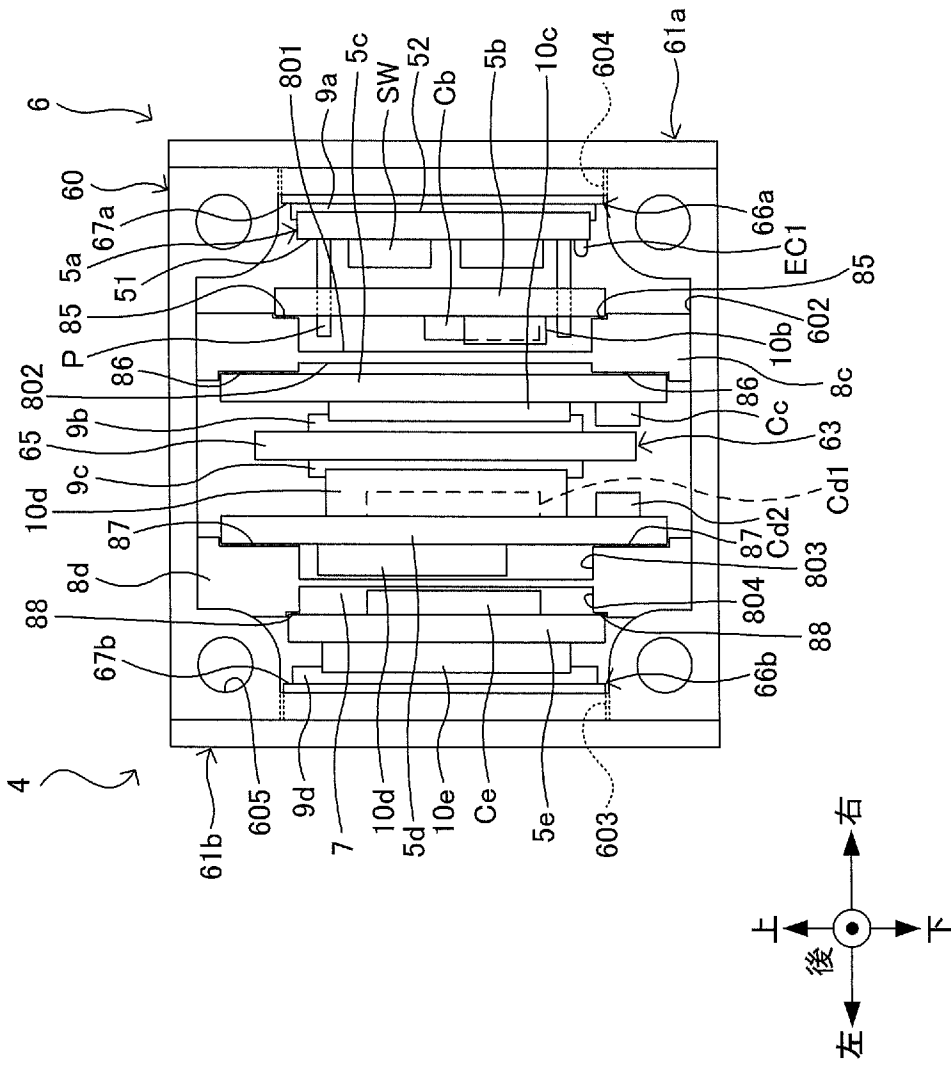
比較例



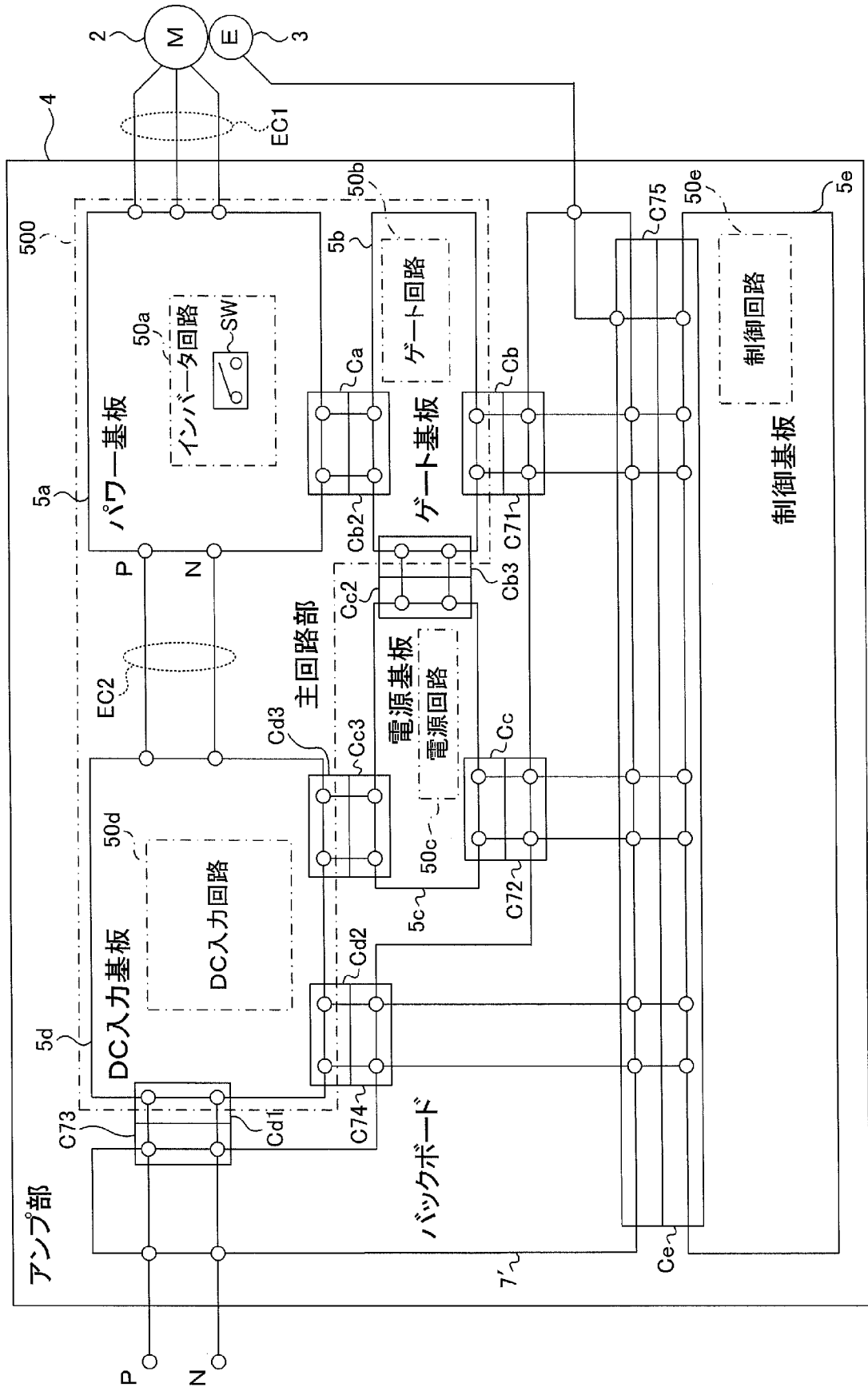
[図11]



[図12]



[図13]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2015/050779

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
H02K11/00(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
H02K11/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2015
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2015	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2015

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2011-163232 A (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.), 25 August 2011 (25.08.2011), entire text; all drawings & US 2011/0193452 A1 & EP 2354549 A2	1-3, 6, 12-13 8-11, 14-15
X Y	JP 2012-92747 A (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.), 17 May 2012 (17.05.2012), entire text; all drawings & US 2013/0119834 A1 & EP 2634427 A1 & WO 2012/056983 A1	1-3, 6, 12-13 8-11, 14-15

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date	"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"&" document member of the same patent family
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	

Date of the actual completion of the international search 03 March 2015 (03.03.15)	Date of mailing of the international search report 17 March 2015 (17.03.15)
---	--

Name and mailing address of the ISA/ Japan Patent Office 3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan	Authorized officer Telephone No.
--	---

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2015/050779

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 6-30547 A (Goldstar Co., Ltd.), 04 February 1994 (04.02.1994), entire text; all drawings & US 5331239 A & DE 4243044 A1 & KR 10-1995-0014645 B1	1-4, 6, 12-13, 16 8-11, 14-15
X	JP 2004-282905 A (Hitachi, Ltd.), 07 October 2004 (07.10.2004), entire text; all drawings & US 2004/0183385 A1 & EP 1460749 A1	5-7
Y	JP 2012-180828 A (Aisan Industry Co., Ltd.), 20 September 2012 (20.09.2012), entire text; all drawings & US 2013/0034455 A1 & DE 102012002096 A & CN 102628444 A	8-11, 14-15
Y	JP 2-266854 A (Honda Motor Co., Ltd.), 31 October 1990 (31.10.1990), entire text; all drawings (Family: none)	8-11, 14-15
Y	JP 11-313465 A (Toshiba Corp.), 09 November 1999 (09.11.1999), entire text; all drawings (Family: none)	8-11, 14-15

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. H02K11/00(2006.01)i		
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. H02K11/00		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2015年 日本国実用新案登録公報 1996-2015年 日本国登録実用新案公報 1994-2015年		
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X Y	JP 2011-163232 A（三菱重工業株式会社）2011.08.25, 全文, 全図 & US 2011/0193452 A1 & EP 2354549 A2	1-3, 6, 12-13 8-11, 14-15
X Y	JP 2012-92747 A（三菱重工業株式会社）2012.05.17, 全文, 全図 & US 2013/0119834 A1 & EP 2634427 A1 & WO 2012/056983 A1	1-3, 6, 12-13 8-11, 14-15
X Y	JP 6-30547 A（株式会社金星社）1994.02.04, 全文, 全図 & US 5331239 A & DE 4243044 A1 & KR 10-1995-0014645 B1	1-4, 6, 12-13, 16 8-11, 14-15
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 03.03.2015	国際調査報告の発送日 17.03.2015	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（ISA/J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官（権限のある職員） 下原 浩嗣 電話番号 03-3581-1101 内線 3357	3V 9179

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 2004-282905 A (株式会社日立製作所) 2004. 10. 07, 全文, 全図 & US 2004/0183385 A1 & EP 1460749 A1	5-7
Y	JP 2012-180828 A (愛三工業株式会社) 2012. 09. 20, 全文, 全図 & US 2013/0034455 A1 & DE 102012002096 A & CN 102628444 A	8-11, 14-15
Y	JP 2-266854 A (本田技研工業株式会社) 1990. 10. 31, 全文, 全図 (ファミリーなし)	8-11, 14-15
Y	JP 11-313465 A (株式会社東芝) 1999. 11. 09, 全文, 全図 (ファミリーなし)	8-11, 14-15